概覽

我們是全球領先的高性能非易失性存儲芯片設計公司，我們以無晶圓廠模式營運，專注於設計流程及外包晶圓製造、封裝及測試，致力於滿足人工智能時代高速迭代與擴容的存儲需求，為客戶研發及供應(i)關鍵非易失性存儲芯片，如串行檢測集線器(SPD)芯片（該品類下的主要產品）、電可擦除可編程只讀存儲器(EEPROM)芯片及或非易失性閃存(NOR Flash)芯片；(ii)攝像頭馬達驅動芯片；及(iii)NFC（近場通信）芯片及配套解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料，於2023年、2024年及2025年，按收入計，我們是全球排名第三的EEPROM供應商以及排名第二的DDR5 SPD芯片供應商。憑藉強大的技術研發專長與全球市場積累，我們的產品組合現已覆蓋AI基礎設施、汽車電子、工業控制、消費電子等廣泛的存儲應用場景。

存儲芯片已滲透至人類社會運轉的方方面面。AI基礎設施（如數據中心和服務器集群）正隨著人工智能的發展而迅速擴張。智能駕駛、視覺感知等隨著汽車智能化發展不斷革新的車規級應用，乃至智能手機、家電等日常隨處可見的消費電子領域，均依賴於高性能且高可靠的存儲芯片產品。存儲芯片不僅承擔著系統啟動、參數存儲、程序加載等基礎功能，更在實時數據處理、邊緣計算、多任務併發等複雜場景中發揮著關鍵作用，其應用範圍延伸至幾乎所有電子場景，成為支撐數字化社會運轉不可或缺的核心元件。

AI時代，算力承擔模型訓練與推理的核心運算任務，而存力在數據的採集、傳輸、緩存與持久化方面發揮關鍵基石性的作用。在人工智能的驅動下，大模型訓練規模持續擴大，推理應用向各類終端行業加速滲透，全球數據的快速增長正在加速存儲技術的升級，並重塑存儲類芯片產業的角色與價值。

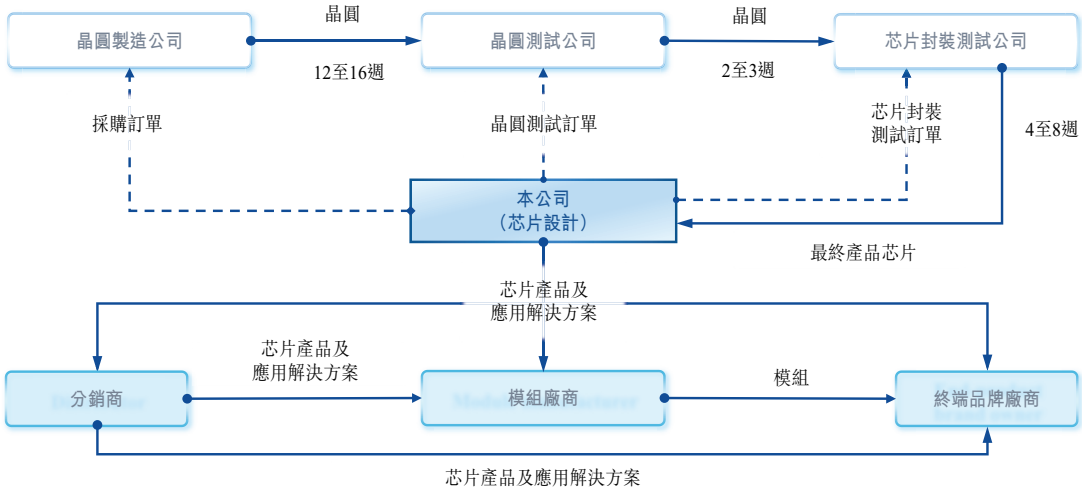
在這一趨勢下，當前存儲芯片的裝載密度和性能要求正在被提升至前所未有的高度。隨著人工智能、物聯網、5G通信等新一代信息技術的深度融合與快速滲透，各類電子設備對數據存儲的容量、速度、功耗及可靠性提出了更為嚴苛的要求。

基於逾16年的行業深耕與對市場需求的深刻理解，我們已開發出以非易失性存儲芯片、攝像頭馬達驅動芯片以及NFC芯片為核心的產品線。我們追求項目定點以展示我們的技術能力並建立客戶信任、推動產品從試產邁向量產，並利用這些已建立的關係把握交叉銷售機會。因此，我們的產品已得到全球內存模組巨頭、中國及境外知名汽車企業、主流智能手機廠商等下游終端客戶的廣泛應用。根據弗若斯特沙利文的資料，2025年，我們按收入計擁有全球DDR5 SPD芯片市場超過40%的份額，且按收入計擁有全球EEPROM市場14.8%的份額，並在多個細分產品領域擁有全球領先的研發能力與市場地位，具體而言，我們是：

- 以收入計，2023年、2024年及2025年全球排名第三的EEPROM供應商，
- 以收入計，2023年、2024年及2025年中國排名第一的EEPROM供應商，及
- 以收入計，2023年、2024年及2025年全球第二大的DDR5 SPD芯片供應商。

我們的業務模式

我們採取無晶圓廠業務模式，專注於集成電路產品的研發、設計與銷售。



我們的產品亮點

我們的產品組合包括(1)涵蓋若干核心存儲應用場景的非易失性存儲芯片，包括以全系列SPD芯片為亮點的存儲模組配套芯片（該等芯片為基於EEPROM的非易失性存儲芯片，支持廣泛應用於AI服務器及AI PC的DDR2至DDR5內存模組）、面向汽車電子、工業控制的高可靠性存儲芯片以及面向消費電子領域的存儲芯片；(2)攝像頭馬達驅動芯片；及(3)其他產品，主要包括NFC芯片。

存儲模組配套芯片

我們採用了共同開發模式，使我們能夠成為全球主要內存公司（尤其是全球一流的動態隨機存取存儲器（DRAM）模組公司）的核心供應商。AI浪潮驅動服務器與PC等AI基礎設施內存配置顯著升級，當前主流的AI服務器通常需要部署超過20根DDR5內存模組，是傳統通用服務器的2倍左右，AI PC應用的加速滲透也在驅動客戶不斷迭代內存配置需求。我們自DDR2世代即已研發內存模組配套SPD芯片，針對最新的DDR5內存技術，憑藉多年的量產經驗與核心技術積累，我們與一家全球領先的內存互聯芯片供應商進行戰略合作。隨著DDR5內存模組在數據中心、邊緣計算等場景的加速滲透，我們相信我們的SPD芯片技術將持續獲得內存模組企業的認可，也為中國乃至全球數字基礎設施的安全可控提供底層技術支持。

我們為合作夥伴的DDR5內存接口解決方案提供核心的SPD芯片，其是服務器中DRAM模組的關鍵部件。因此，我們在加速產品推出方面受益於這一協同合作，且能夠迅速觸達全球主要的DRAM模組供應商。全球服務器DRAM市場高度集中，頂級廠商佔據了絕大部分市場份額，這一格局使我們能夠抓住市場的快速增長機遇。根據弗若斯特沙利文的資料，全球前三的DRAM供應商於2025年合計佔全球服務器DRAM行業90%以上的市場份額，且以收入計，我們是2023年、2024年及2025年全球第二大的DDR5 SPD芯片供應商。

此外，我們正積極拓展新產品線，並已推出配套下一代高性能存儲設備的VPD芯片。VPD芯片已成為新一代企業級固態硬盤(eSSD)模組及CXL(Compute Express Link)內存模組的關鍵組成，用於提供關鍵參數管理、設備識別及系統級校驗能力。隨著大模型訓練與推理規模不斷擴大，AI服務器與高性能計算系統對存儲性能、可靠性與管理能力提出更高要求，eSSD與CXL的技術標準隨之持續升級，對VPD芯片的準確性、穩定性和接口能力亦提出更嚴格規範。在VPD芯片領域，我們已與牽頭制定行業標準及產品規範的全球領先存儲廠商建立合作，成為首家進入該公司產品設計驗證階段、支持其新一代eSSD模組和CXL內存模組的VPD開發商，從而構築技術與客戶壁壘。

用於汽車電子的高可靠性存儲芯片

對高可靠性產品的需求正在行業中構築競爭型壁壘，使我們這樣的領先企業受益。汽車電子是當前存儲芯片領域最具確定性和增長潛力的核心市場之一。當前，由電動化、智能化、網聯化驅動的汽車電子電氣架構升級，正推動汽車存儲芯片迎來結構性的需求躍遷。在實際應用層，各核心模塊的功能提升直接拉動整車存儲配置需求的增長：智能座艙向多屏化與高性能計算平台的演進、智能駕駛系統向更高等級的進階、車身各域控制器數量的顯著增加，整車對於EEPROM、NOR Flash等高性能存儲芯片在參數與固件存儲等環節的用量持續攀升。根據弗若斯特沙利文的資料，預計新能源汽車的全球銷量將由2026年的28.3百萬輛增加至2030年的44.3百萬輛，複合年增長率為11.9%。與通常用於單個內燃機(ICE)車輛的10-15顆的EEPROM相比，新能源汽車的EEPROM數量已增至30-40顆。

汽車電子對於存儲芯片的可靠性、溫度適應能力與抗干擾能力提出嚴苛要求，因此具備更高的品控要求和開發難度。我們用於汽車電子的高可靠性存儲芯片符合AEC-Q100 A1-A2標準，EEPROM容量覆蓋1Kb-4Mb、NOR Flash容量覆蓋512Kb-16Mb，已在視覺感知、智能座艙、三電系統、底盤傳動與車身控制等汽車四大系統的數十個子模塊中得到了廣泛的應用。

汽車系統	汽車子模塊
視覺感知	ADAS 座艙監測和內部攝像頭 輔助全景感知 AVM
智能座艙	儀錶盤 中控屏 IVI系統 人機交互
底盤與車身	EPS/ABS BCM/VCU/TPMS 安全氣囊 車窗／門控制器
EIC系統	電驅動 BMS系統 OBC

順應國內車企國產化趨勢，我們的產品已廣泛應用於全球前20大中的16大、中國前20大的所有汽車品牌以及中國逾85%的自主乘用車品牌的多個核心車載模塊。鑒於車規級認證通常需要較長的嚴格驗證週期，這種深度合作模式建立了天然的客戶壁壘和長期綁定優勢。這一市場地位不僅印證了我們的技術實力，更為我們進一步提升市場佔有率、鞏固領先地位提供了有力支撐。

應用於消費電子領域的存儲芯片

憑藉逾16年的行業經驗，我們持續推動產品升級，以滿足人工智能時代尚未被滿足的需求。例如，我們的EEPROM作為一種基礎存儲元器件芯片，已廣泛應用於各類消費電子終端產品。AI技術的發展正在推動消費電子終端產品的智能化升級，隨著消費電子終端產品功能持續創新、品類不斷豐富，存儲芯片的應用廣度與深度同步提升，市場規模持續擴大。我們的產品已在智能手機、液晶面板、藍牙模塊等多個關鍵細分領域建立起全球領先的市場地位，產品滲透率穩步提升。我們也正在積極把握邊緣AI蓬勃發展的歷史性機遇，將產品應用場景拓展至新興領域，以加強我們的發展動力。

我們應用於消費電子領域的存儲類芯片包含高性能EEPROM以及先進的NOR Flash產品。我們提供覆蓋1Kb-4Mb容量區間的全系列EEPROM芯片。我們的NOR Flash產品聚焦低功耗SPI NOR Flash芯片系列（通過串行接口訪問的NOR Flash存儲器），包括基於我們NORD工藝平台的覆蓋512Kb-64Mb容量區間的NOR Flash芯片，以及基於ETOX工藝平台的覆蓋32Mb-512Mb容量範圍的NOR Flash產品儲備，以滿足若干消費電子終端產品的更大固件需求，為客戶提供多層次選擇。

我們長期深耕智能手機這一消費電子領域內市場規模最大的細分市場，我們的EEPROM芯片自2011年起即已應用於全球領先智能手機品牌之一的攝像頭模組中。我們的產品已廣泛應用於全球多家市場主流廠商的智能手機品牌產品以及多家全球知名消費電子企業的終端產品。

單一場景中的多元化應用

我們長期以來一直深耕智能手機市場－消費電子領域最大的細分市場－不斷提升業務能力，並深化在智能手機應用領域的科技市場滲透。例如，在智能手機領域，我們的產品整合到多個關鍵模組中，發揮重要作用：

- EEPROM芯片是智能手機攝像頭模組的首選儲存技術。隨著智能手機進入成熟用戶群時代，以及消費者對高品質攝影和攝像功能的需求持續增長，攝像頭技術創新已成為各主要手機製造商差異化的關鍵焦點。攝像頭模組需要儲存的數據量，包括鏡頭參數、白平衡參數、自動對焦位置信息等，都在不斷增加。EEPROM芯片憑藉其多功能性、高可靠性、穩定的數據儲存以及數百萬次寫入的耐用性，能夠有效滿足攝像頭模組的各種參數存儲需求。此外，EEPROM還具有功耗低、寫入電流小、靜電放電保護性能優異等優點，成為該應用領域的首選儲存技術。

- 攝像頭馬達驅動芯片控制智能手機攝像頭中的自動對焦(AF)和光學防抖(OIS)。為了優化使用者攝影體驗，AF和OIS已成為提升智能手機攝像頭功能和增強影像品質的關鍵技術。我們的攝像頭馬達驅動芯片產品線涵蓋開

環AF、閉環AF、獨立OIS和集成OIS解決方案，並已廣泛部署於各主要智能手機品牌的攝像頭模組中。我們也自主研發了一種將攝像頭馬達驅動芯片與EEPROM芯片二合一的技術，顯著縮小了攝像頭模組中兩個獨立芯片的體積，進一步提升了我們的產品競爭力。

- NOR Flash芯片適用於相對而言對儲存容量要求較高的應用。智能手機需要中小容量的代碼型記憶體來執行內部指令、系統數據交換和其他功能，而NOR Flash芯片在這些應用中具有效能和成本優勢。我們的NOR Flash芯片系列目前已廣泛應用於智能手機的AMOLED顯示器和TDDI（觸控和顯示驅動集成）控制器中。

- NFC芯片可實現與支持NFC功能的智能手機的無縫短距離通訊。NFC連線功能已成為主流智能手機的標配功能，我們的NFC芯片設計兼顧廣泛的互通性和實用安全性，符合NFC論壇技術規範和通用的ISO/IEC短距離通訊標準。芯片內嵌EEPROM/NOR Flash芯片，用於儲存固定識別碼和應用數據，用戶可透過智能手機進行配置更新、功能啟用和售後支持操作，從而進一步降低終端客戶大規模部署的管理成本。

我們的市場機會

AI服務器及AI PC

- 隨著大模型訓練與推理加快落地，全球AI基礎設施進入新一輪投資週期，用於承載雲端算力的AI服務器市場以及具備本地推理能力的AI PC市場正迎來爆發式增長。據弗若斯特沙利文資料，2026年全球AI服務器出貨量預計將突破3.2百萬台，2030年將達到7.8百萬台，期間複合年增長率約為25.0%；AI PC滲透率有望由2026年的42.0%提升至2030年的85.0%。

- AI基礎設施的加速放量帶來整機存儲配置數量的系統性提升。數據中心側，主流AI服務器通常部署超過20根DDR5內存模組，是傳統服務器的兩倍，AI服務器集群規模持續擴大，服務器逐步配置更多DRAM及SSD（固態硬盤，一種使用閃存的快速耐用的存儲設備）模組；終端側，AI PC在PC端加快滲透，較之傳統產品，其配置更大容量的DRAM及SSD。雲端與終端兩端同時擴張，使設備數量和單機配置需求均呈加速上行趨勢，整體內存模組及對應存儲芯片的裝機總量隨之大幅增加。

- 在此背景下，我們已投入商業應用並支持DDR5的SPD芯片，以及目前正處於認證階段、用於eSSD和CXL模組的VPD芯片，有望獲得全球主要雲服務商、服務器廠商及AI PC品牌的採用及／或更廣泛部署，從而擴大我們的核心客戶覆蓋範圍，並深入滲透至AI基礎設施領域。

汽車電子

- 汽車智能化、電動化、網聯化轉型持續推進，整車電子電氣架構加速向域控制、區域控制演進。智能駕駛域控制器、智能座艙域控制器以及車身、底盤、電池管理等控制單元數量明顯增加，單車配備的存儲芯片在種類和數量上均明顯高於傳統燃油車，呈現由「少量關鍵節點」向「多域多節點」擴展的升級趨勢。

- 汽車電子EEPROM芯片市場正迎來規模的爆發式提升。據弗若斯特沙利文統計，全球汽車電子EEPROM芯片市場規模於2030年預計將超過700.0百萬美元。隨著ADAS、智能座艙、新能源三電系統等應用在更多車型和更多配置檔位中導入，單車所需的控制單元數量持續增加，相應需要在感知、控制、顯示、動力等多個模塊中配置獨立的存儲芯片，用於支撐軟件運行和功能管理。滲透率的提升與單車存儲點位的增加使車規級存儲芯片總體用量呈現持續上行趨勢。

- 我們擁有應用於汽車電子領域的EEPROM、NOR Flash等高性能存儲類芯片產品，憑藉產品的高可靠性和穩定性，有望隨著市場擴容趨勢加速滲透全球汽車品牌的各類車型及功能模塊。

消費電子

- 消費電子終端出貨規模大、下游覆蓋人群廣，產品保有量和更新需求均處於較高水平，且邊緣AI功能在不同價位、不同形態產品中正在持續滲透，單機存儲芯片用量整體呈上升趨勢，為存儲芯片提供了體量可觀且持續擴大的應用空間。據弗若斯特沙利文統計，2025年全球支持邊緣AI的消費電子設備出貨量將突破850百萬台，滲透率超40.0%。

- 消費電子行業驅動存儲芯片市場成長，得益於人工智能物聯網解決方案需求的上升，以及邊緣AI設備部署的加速；同時，蓬勃發展的TWS耳機與智能手錶市場，需依靠高密度、低功耗的存儲芯片產品來承載複雜固件與即時連線功能，維持穩定需求。

- 我們的存儲類芯片產品已應用於智能手機及邊緣AI應用，在多家品牌客戶中實現批量出貨，邊緣AI的快速發展也將持續擴大市場對我們產品的需求規模。

我們的優勢

在多個存儲細分市場保持差異化能力，有效抓住結構性增長機會

我們並未依賴單一產品或應用，而是發展了差異化的能力，從而能夠持續擴展並複製我們在不同領域的成功。這也得益於我們在SPD芯片、EEPROM、NOR Flash、攝像頭馬達驅動芯片及NFC芯片方面的技術拓展，使我們能夠有效率地應對各種應用場景，並響應AI時代不斷變化的客戶需求。

這些能力使我們能夠積極識別並掌握不斷發展的存儲市場中的新興機遇，尤其是在AI相關應用增長的推動下。我們能夠跨產品週期持續執行，並跨領域擴展我們的能力，從而創造一種可擴展且難以複製的優勢，使我們能夠隨著時間的推移在不同細分市場中有效把握新興機遇並鞏固我們的市場地位。

在連續幾代產品中以客戶為導向的創新

我們構建了涵蓋SPD芯片、EEPROM、NOR Flash及攝像頭馬達驅動芯片等存儲及混合信號類芯片及NFC系列產品的完整解決方案，並持續推進VPD芯片的認證工作。同時，我們正在推動閉環式及光學防抖式攝像頭馬達驅動芯片等高端產品的規模化量產交付，以全代際、高可靠性、高性能的產品組合，精準匹配不同市場的各類差異化需求，並逐步切入邊緣AI等快速增長的新興市場。

歷經多行業嚴苛場景驗證，我們的產品質量已在品質和可靠性要求極高的應用端得到充分的認證。於2023年、2024年、2025年及2026年上半年，我們的存儲類芯片在客戶端的失效率遠低於業界對商業級電子元器件應用50 PPM失效率的要求；我們的應用於汽車電子領域的高性能存儲類芯片能夠覆蓋A1-A2等級適應性標準，擁有IATF 16949符合性認證，並通過AEC-Q100系列標準測試，達到業內商業化最高性能；我們的高可靠性EEPROM芯片具有寬電壓、高兼容性、低功耗等特點，常溫條件下的耐擦寫次數高達400萬次，數據存儲時間長達200年。

我們根據客戶的意見開發新產品，通過與客戶深度協同的合作模式，鞏固了我們的新產品定義能力。

- 在DDR5 SPD方面，我們正與全球領先的內存互聯芯片供應商瀾起展開戰略合作。

- 在VPD方面，我們正與全球領先的存儲廠商建立合作，成為首家進入該公司產品設計驗證階段的VPD芯片開發商，為其新一代eSSD模組與CXL內存模組提供支援，為加速商業化與部署奠定基礎。

- 在攝像頭馬達驅動芯片等相關產品領域，我們與知名智能手機品牌廠商及攝像頭模組廠商在新技術開發、產品規格定義及新產品驗證等方面開展系統合作，持續提升在閉環式及光學防抖攝像頭馬達驅動芯片方面的芯片研發、算法開發及系統調試能力，為閉環式及光學防抖相關業務的拓展提供技術支撐，並進一步強化與核心客戶的合作黏性。

- 對於NFC芯片，我們繼續縮小芯片面積、提升射頻靈敏度，並擴充封裝方案選擇，積極拓展新的應用場景。

高黏性優質客戶群，並可實現高效協同銷售

基於成熟的量產經驗和長期的市場積累，我們已成為全球知名企業信賴的合作夥伴。在存儲模組配套芯片領域，我們與戰略合作夥伴合作開發的配套DDR5內存模組的SPD芯片產品已獲得全球主流存儲廠商的規模化應用；在汽車電子和工業控制領域，我們的產品已廣泛應用於全球前20大中的16大、中國前20大的所有汽車品牌以及中國逾85%的自主乘用車品牌的多個核心車載模塊。在消費電子領域，我們的產品已進入多家全球主流智能手機品牌的核心供應鏈，並應用於多家全球知名消費電子企業的消費終端產品。

存儲芯片的品質、可靠性、穩定性對於終端產品的整體性能表現尤為重要，因此存儲芯片行業天然具備高客戶黏性的特徵。在內存模組、汽車電子及工業控制與消費電子等核心應用領域，客戶對供應商的認證流程極為嚴格，認證週期較長，涵蓋可靠性測試、環境適應性評估、長期穩定性驗證及規模化量產能力等多維度考核。這種高門檻的認證體系使得供應商一旦通過認證並實現批量供貨，便不會輕易被客戶更換。憑藉多年的技術積累，我們已在內存模組SPD、汽車電子應用領域EEPROM、智能手機攝像頭及液晶面板EEPROM等細分市場中佔據重要份額，並向主流車企供應存儲芯片。憑藉高客戶黏性的行業特點與已驗證的產品可靠性，公司得以保持長期穩定的領先地位，並為持續提升市場份額奠定了堅實基礎。

依托於我們廣泛且高黏性的客戶積累，我們可以高效實現多類產品的協同銷售。我們以核心優勢產品切入目標客戶供應鏈，實現高品質產品的穩定供貨；在建立口碑並獲得客戶的高度認可後，我們可以圍繞同一客戶承接更多存儲芯片需求，由單一產品延伸至多種產品供應。隨著合作深度提升，我們可以進一步參與客戶新平台或下一代產品的方案討論和規格定義，在產品定義、樣品驗證等早期階段即完成主要產品的

導入，從而縮短新產品上市週期，提升導入成功率，並在優質客戶中穩固並擴大我們的份額。在內存模組領域，我們自DDR2世代起深耕配套SPD芯片，基於SPD芯片產品上獲得的穩定的品質和供應能力方面的口碑與認可，我們獲得了向該領先存儲廠商供應配套新一代eSSD與CXL內存模組的VPD芯片的機會。在汽車電子領域，我們的產品應用已由車載顯示、娛樂等外圍部件逐步延伸至車身控制、底盤及三電系統等核心模塊；在智能手機領域，我們供應的產品由EEPROM進一步拓展至攝像頭馬達驅動芯片及NOR Flash，在重點客戶和主要平台中的產品覆蓋度持續提升。

我們的銷售網絡遍佈全球，依托於我們成熟的分銷商體系，能夠確保產品深度對接各大應用領域的頂尖企業，並維持著長期穩定的戰略合作關係。同時，我們在中國、韓國、美國等重點市場均部署了本地化的銷售或技術支持團隊，密切跟蹤市場動態和客戶需求，能夠為客戶提供及時的現場響應、定制化適配與運維支持。我們通過對客戶需求的快速響應及專業的服務提升客戶的滿意度，進一步增強了客戶對公司產品與服務的黏性。

高速響應、高效協同的供應鏈網絡

我們採用Fabless經營模式，專注於集成電路的設計與研發。基於逾16年的量產歷史，我們已與全球知名晶圓廠及封測廠建立了長期穩定的合作關係。我們的供應鏈合作夥伴不僅具備先進的工藝技術和充足的產能保障，更與我們形成了深度互信的業務協同。

配合我們的國際化戰略，我們不斷完善海外供應鏈網絡，在新加坡、韓國等多地佈局晶圓製造與封裝測試供應鏈條，與多家國際領先的海外供應商進行全球產能深度合作。這一佈局不僅使我們能夠獲取海內外先進的製造工藝，還能有效規避地域性風險，確保供應鏈的安全穩定。通過多元化的供應鏈策略，我們能夠在全球範圍內優化資源配置，平衡成本與效益，為客戶提供持續可靠的產品供應。

富有經驗的管理與研發團隊

我們的管理團隊在IC領域深耕多年，核心成員平均擁有超過二十年的半導體行業經驗或企業管理經驗，曾在多家國際領先半導體企業及優質本土企業擔任重要崗位，具有豐富的技術研發或市場開拓經驗，熟悉全球存儲芯片產業鏈格局及主要客戶需求，在戰略規劃、技術研發、生產運營及市場拓展等方面，形成了強勢的團隊專業互補和高效協同能力。

我們的研發團隊核心人員均擁有集成電路行業相關的學歷背景和國內外知名半導體公司的從業經歷，平均從業年限超過15年，在存儲類芯片設計、工藝開發及系統應用領域具備深厚技術積澱。我們的研發團隊匯聚了在產品規劃、IC設計、測試驗證等關鍵環節具備豐富經驗的專業人才，研發人員佔比約60%，其中碩士及以上學歷人員超過30%。通過在SPD芯片及EEPROM、攝像頭馬達驅動芯片等核心產品領域的持續創新，截至最後實際可行日期，我們已自主獲得80項授權專利及83項產品佈圖設計證書，充分體現了團隊的系統化研發能力和持續突破實力。

我們的戰略

深化我們在成熟細分市場的優勢

我們專注於深耕優勢領域，積極發現和把握行業變革帶來的關鍵機遇，堅持做細分領域的領導者。

- *擁抱AI時代*。人工智能正推動存儲數量和性能的爆發式增長與升級。憑藉我們在DDR5 SPD領域的顯著領先地位，我們率先佈局了面向下一代eSSD及CXL模組的VPD產品，並將鞏固我們的領導地位。同時，我們正積極開發面向終端應用的邏輯芯片，以滿足本地化人工智能應用日益增長的需求。

- *汽車電子領域持續突破*。經過十餘年的技術佈局與市場沉澱，我們在中國車載市場已建立領先地位。我們的客戶不僅覆蓋全部國內主流汽車品牌，更成功覆蓋了大部分海外知名車企和一級供應商。我們將進一步加強海外汽車電子市場的深耕力度，著眼於在全球車載EEPROM芯片市場躋身前二、甚至第一的領先地位，擁抱廣闊的成長空間。

- *消費電子領域加強滲透*。十餘年來，我們在智能手機攝像頭模組及LCD面板的EEPROM解決方案領域始終保持領先地位。展望未來，我們將把握各類消費電子應用中，由新興的邊緣人工智能驅動功能所帶來的新機遇。

繼續深化與各領域頭部客戶的合作，堅持長期發展策略，專注於技術創新，為客戶持續創造價值

隨著非理性投機熱度逐漸退去，半導體行業必然回歸到其注重技術與創新的本質。我們無意參與價格戰，專注於持續創新，聚焦發展有差異化競爭力的產品，為客戶帶來長期價值，以保持企業的長期可持續發展。

- 在攝像頭馬達驅動芯片領域，針對閉環式與光學防抖式攝像頭馬達驅動芯片等高端產品，我們與行業頭部客戶保持深度合作與溝通，通過技術創新解決客戶痛點，助力原本僅應用於高端手機的高性能產品向中端機型甚至千元機滲透，從而顯著擴大整體市場空間。

- 在我們的EEPROM產品佔有較大份額的工業市場，我們將投入資源，發展各類高性能計算產品及周邊配套產品，藉此拓展在新能源、工業電源和工業控制、AIDC電源、固態變壓器(SST)等領域的應用。

- 基於我們現有存儲產品的行業領先地位，我們關注行業的發展趨勢及響應客戶的長期需求，積極拓展並研發新型存儲解決方案，持續為客戶及我們自身帶來價值。

我們已經建立了一個跨越半導體價值鏈的多元化合作夥伴生態系統，包括全球領先的存儲廠商、汽車品牌及消費電子公司。我們的合作因夥伴關係的性質而採取不同的形式。其中包括，例如，與技術領先者共同開發下一代產品，以符合不斷發展的行業標準；在早期設計階段與制定產品規格和市場方向的夥伴合作；及在行業領先的參與者的整個產品開發和驗證週期與其緊密合作，以確保長期的平台地位。這些合作方式使我們能夠很好地把握人工智能、汽車、工業及消費類應用領域的新興機遇。

依托平等、開放、高效、務實的企業文化，以多種方式持續拓展我們的產品線

良好的企業管理文化是企業長期健康發展的生命線。我們堅持平等、開放、高效且務實的管理理念，以客戶為導向，堅持做正確的事，溝通與執行都極為高效。我們的員工專注為公司和客戶創造價值，而公司亦致力於為客戶和員工創造價值。我們

持續反思，客觀認識自身的不足與邊界，以不斷進步的姿態接納先進的新知識、新市場、新產品與新團隊。

在這一企業管理文化基礎上，我們將以多種方式持續拓展我們的產品線：

- 依托於我們的客戶基礎與技術積累持續拓展產品類型與應用。一方面，基於與優質客戶的深度合作與互信關係，在客戶同一應用場景中拓展其他可用產品；另一方面，基於我們在優勢產品中積累的know-how，進一步延伸至新的客戶群體和市場應用。

- 持續關注市場上具有潛力的技術方向及人才團隊，並通過提供良好的發展環境與激勵體系吸引具備產品開發能力的外部人才和團隊，以推動新產品的研發與拓展。

- 尋找具備行業先進性、高壁壘、與現有業務具協同效應且符合產業趨勢的潛在標的，並在審慎評估的基礎上穩健推進戰略投資與整合，以加速技術與產品佈局。

深化海外佈局，強化供應鏈與團隊建設

我們將繼續深化海外佈局，著力加強供應鏈體系的建設與優化。在既有海外客戶和業務基礎上，我們將穩步拓展與各地合作夥伴的協作關係，提升採購、質量管理與交付環節的本地化水平，增強供應鏈的穩定性與靈活性，更好應對國際環境變化帶來的不確定性。同時，結合我們的產品向高端應用發展的需求，我們將會引入更成熟的海外工藝與技術資源，為未來產品性能提升提供可靠保障。

我們也將積極建設國際化專業團隊。通過吸引海外優秀技術團隊並推進合作，我們不斷提升研發與設計能力，為技術升級和全球業務拓展提供持續支持。

我們的發展歷程

我們的長遠願景一直是建立一家處於非易失性存儲芯片及攝像頭馬達驅動芯片技術前沿的全球性無晶圓廠半導體公司，為各行各業的應用開發並提供先進、AI驅動的存儲類芯片解決方案。我們專注於商業洞察與技術創新的交匯。直至今天，這一點從未改變－我們利用專有技術及跨行業、跨業務流程的深厚專業知識，提供創新的存儲類芯片產品及解決方案，為客戶創造價值。多年來，我們圍繞一項商業戰略，即識別那些對我們的技術能力有重大未滿足需求以解決其應用問題的行業及客戶，從而能夠持續創新、開發及應用我們的技術能力，並推動業務發展。

我們採用無晶圓廠製造戰略，專注於非易失性存儲芯片及攝像頭馬達驅動芯片產品及解決方案的設計與銷售，並與世界領先的供應商在晶圓製造、封裝及測試方面進行合作。我們業務的核心是半導體設計，這涉及將設計要求及功能轉化為特定物理電

路版圖的複雜過程。此過程的關鍵步驟包括系統規格制定、RTL編碼、電路設計、模擬及驗證。我們相信，無晶圓廠模式降低了我們的資本需求、營運開支及產品上市時間，這反過來使我們能夠集中資源，致力於發展我們在研發、技術創新及產品設計方面的核心競爭力。

下文列示了我們自2009年成立以來的主要發展里程碑的若干亮點：

- 2011年－成功進入全球領先手機製造商的供應鏈。
- 2015年－開始開環攝像頭馬達驅動芯片量產。
- 2016年－成為全球智能手機EEPROM的頭部供應商，並作為全球領先智能手機企業的關鍵供應商。
- 2018年－推出自研的攝像頭馬達驅動＋EEPROM二合一整合產品。
- 2021年第四季度－開啟車規級EEPROM產品量產供應，與我們的戰略合作夥伴共同開發的DDR5 SPD芯片按聯合電子設備工程委員會(JEDEC)標準進入商業化階段。
- 2021年－取得IATF 16949汽車品質管理體系證明；EEPROM技術取得突破性進展：實現4百萬次編程／擦除循環與200年數據保存能力。
- 2023年－獲評國家級專精特新「小巨人」企業。
- 2024年－榮獲上海市製造業單項冠軍產品（EEPROM存儲芯片）。

我們先進的產品供應

我們的產品組合包括(1)涵蓋若干核心存儲應用場景的非易失性存儲芯片，包括以支持DDR2至DDR5內存模組的全系列SPD芯片為亮點的存儲模組配套芯片，主要專注於DDR5，面向汽車電子、工業控制的高可靠性存儲芯片以及面向消費電子領域的存儲芯片；(2)攝像頭馬達驅動芯片；及(3)其他產品，主要包括NFC芯片。

非易失性存儲芯片

非易失性存儲芯片為身份識別、配置及校準數據以及可執行代碼提供存儲，在現代內存模組中，亦能夠實現管理及溫度傳感。我們供應非易失性存儲芯片，實現數據長期保留及在多種應用場景下穩定運行。在該等非易失性存儲芯片內，我們將產品供應分為下述三大應用導向類別。

- *存儲模組配套芯片，主要包括安裝於個人電腦及服務器所用的DDR（雙倍數據速率）DRAM模組中的SPD芯片*。SPD芯片是該類別下的主要供應產品，用於內存模組身份及時序參數，同時在DDR5負責協調I^2C及I^3C及感知溫度。此外，我們正在開發VPD芯片，旨在為下一代企業級SSD提供模組身份及配置存儲，將我們的模組管理專業能力從DRAM模組延伸至企業級存儲領域。

- *面向汽車電子與工業控制的高可靠性存儲類芯片，包含車規級與工業級存儲芯片*。該細分領域對可靠性、耐溫性及認證（如AEC-Q100、IATF 16949）的要求較消費級產品更加嚴格，形成了較高的准入壁壘。這些努力構築了堅實的競爭壁壘。我們已服務於全球前二十大車企中的十六家，且相對較長的汽車認證週期為我們用於汽車電子及工業控制的存儲芯片創造了強大的客戶黏性。

- *面向消費電子領域的存儲類芯片*。與車規級及工業級產品相比，面向消費電子領域的存儲類芯片的認證要求側重於超低功耗與微型尺寸。我們在該細分領域的存儲芯片應用範圍更為廣泛（涵蓋智能手機、手持雲台、可穿戴設備、家用電器等），且產品可靠性可針對典型消費級產品的生命週期進行校準。

存儲模組配套芯片

我們設計並供應SPD芯片，其為從DDR2到DDR5的各代DDR提供所需的身份識別、配置存儲、管理通道及熱遙測功能（當前主要專注於DDR5）。每個DDR模組均搭載一顆SPD芯片，其為基於EEPROM的非易失性存儲芯片，用於儲存模組的身份識別及時序參數，使系統可於上電時正確初始化內存並按額定性能運行。在DDR5中，SPD亦集成一個I^2C/I^3C集線器，用於協調模組內設備之間的邊帶總線，並在SPD位置集成了一個高精度溫度傳感器。JEDEC標準要求DDR5模組配有PMIC，以管理本地供電，而我們的SPD通過管理通道與PMIC及TS協同運行，從而支持符合標準的配置及熱控制。

我們逐代構建起該條產品線。在DDR2及DDR3時代，我們建立了涵蓋主流模組類型的完整SPD產品組合，藉此與主要模組製造商建立了關係。於2022年上半年，我們藉助市場範圍內的DDR4 SPD供應短缺，擴大在頭部模組廠商的佈局。我們於該期間的舉措鞏固了我們的SPD芯片產品在可靠交付及快速平台適配方面的聲譽。

向DDR5的過渡標誌著在規格及市場機遇方面的階躍式轉變。我們於2021年第四季度推出DDR5。此後主要的內存模組公司開始大規模部署我們聯合開發的DDR5 SPD芯片。我們正與內存互連芯片全球領軍企業瀾起展開戰略合作。我們與瀾起共同開發了支持下一代內存模組的DDR5 SPD芯片。在該等合作過程中，各方保留其獨立開發與DDR5 SPD芯片相關的技術及知識產權的所有權，同時雙方共同承擔相關的研發開支及生產成本，並分享銷售該等產品所產生的毛利。透過密切關注終端用戶的產品需求，我們能夠更精準地規劃我們的芯片產品並界定產品規格，從而有效降低與新產品相關的研發風險，並提升其於終端應用的適用性及市場競爭力。我們於DDR5 SPD領域已建立市場領先地位。根據弗若斯特沙利文的資料，於2023年、2024年及2025年，按收入計，我們是全球第二大DDR5 SPD芯片供應商。

我們的產品封裝形式與平台覆蓋能力已隨市場需求擴展。我們的DDR5 SPD不僅適用於台式機、筆記本電腦及服務器所用的內存模組形式（包括UDIMM（台式機常用的標準內存模組）、SODIMM（專為筆記本電腦和小型設備設計的緊湊型內存模組）和RDIMM（服務器和數據中心常用的內存模組）），還支持CAMM/CAMM2（一種更薄的內存模組設計，使筆記本電腦更纖薄）及LPCAMM/LPCAMM2（CAMM的節能版本，專為超薄筆記本電腦和便攜式設備而設計）等新型輕薄外形內存模組封裝形式。該等內存模組要求每個模組配置1顆SPD和1顆PMIC。隨著高端輕薄筆記本及其他電子產品從舊款的低功率雙倍數據速率(LPDDR)逐步過渡到LPCAMM2，DDR5 SPD芯片的需求

隨之增加。此外，我們的DDR5 SPD涵蓋RDIMM（用於服務器以提高穩定性的帶有寄存器的內存模組）、LRDIMM（用於服務器和數據中心的減負荷內存模組）、MRDIMM（用於為人工智能和高性能計算提供更高帶寬的多路複用列內存模組）及SOCAMM/SOCAMM2（專為邊緣服務器和嵌入式系統設計的緊湊型內存模組）等內存模組封裝形式。根據JEDEC標準，一款典型DDR5服務器DIMM需搭載1顆SPD、2顆TS及1顆PMIC。AI服務器單系統通常配置20餘條DIMM，約為主流通用服務器的兩倍。這使得我們SPD芯片的單位需求數量成倍增加，創造了對我們DDR5 SPD芯片的巨大需求。

我們強大的技術實力與標準合規能力是該產品線的基礎支撐。我們的SPD集線器專為DDR5 DIMM上符合JEDEC定義的I^2C及I^3C管理通道（系統與內存模組組件通信和配置的標準接口）設計，使系統控制器能夠高可靠地發現和配置模組內設備、讀取重要產品數據及監測熱狀態。嵌入式非易失性SPD可在模組整個生命週期內保存身份識別與配置數據，即使在斷電狀態下也不會丟失。集成溫度傳感器（TS）能在SPD位置提供持續讀數，以支持熱管理及性能降額策略。

2023年，我們啟動了一款VPD芯片的研發，這是首款支持下一代eSSD模組和CXL內存模組且已進入設計驗證階段的VPD芯片，讓我們的模組管理專業能力不只局限於DRAM領域，而是與行業在企業級存儲產品中推行標準化非易失性身份標識的發展趨勢保持一致。

存儲模組配套芯片的關鍵特徵及應用場景

我們的DDR5 SPD集成了三個功能模塊，即用於身份識別及配置的8 Kb EEPROM、符合JEDEC定義的DDR5 DIMM上的I^2C/I^3C管理通道的I^2C/I^3C集線器，以及位於SPD位置的高精度溫度傳感器，用於本地熱遙測。我們的DDR5 SPD已實現量產，可應用於UDIMM、SODIMM、CAMM/CAMM2、LPCAMM/LPCAMM2、SOCAMM/SOCAMM2、RDIMM、LRDIMM和MRDIMM。我們與瀾起聯合開發了DDR5 SPD，該產品於2021年底開始被主要內存模組公司大規模部署。相較於DDR4 SPD，我們的DDR5 SPD具備更高規格與更豐富的模組內容，提升了每片DDR5 SPD模組的價值。此外，AI服務器與AI PC的廣泛應用，進一步增加了對我們DDR5 SPD芯片的市場需求。

我們的存儲模組配套芯片應用場景包括但不限於：

- *PC*。我們的DDR5 SPD應用於台式機和筆記本電腦的UDIMM和SODIMM以及在新型筆記本電腦和緊湊型設計中日益普及的新型輕薄封裝形式CAMM/CAMM2和LPCAMM/LPCAMM2。隨著行業邁向AI PC時代，這些系統中的內存模組往往會承載更多的存儲芯片，從而為我們創造更多機會。

- *數據中心、服務器和AI服務器*。在數據中心中，DDR5 SPD負責處理RDIMM、LRDIMM和MRDIMM格式的識別和管理總線通信，同時亦支持用於加速器級和AI服務器設計的SOCAMM/SOCAMM2格式。AI服務器單系統通常使用超過20條DDR5 DIMM，約為主流通用服務器的兩倍。隨著AI服務器採用更多DDR5 DIMM，對我們DDR5 SPD的需求相較DDR4預期將實現增長。此外，全球最大的GPU供應商之一的下一代GPU解決方案將採用SOCAMM2內存模組形態，而該解決方案同樣需要依靠DDR5 SPD芯片來完成存儲參數配置。

- *企業級SSD*。2023年，我們開始開發一款VPD芯片，為下一代eSSD模組和CXL內存模組帶來身份識別和配置功能。VPD芯片可在各SSD之間實現一致的身份識別、現場更新和全隊列管理。

- *傳統和嵌入式系統*。我們的DDR3及DDR4 SPD芯片仍可用於工業、嵌入式和專用計算領域的長生命週期平台。

在該等應用場景中，我們的SPD芯片的嵌入式非易失性EEPROM即使在斷電情況下也能保存身份識別和配置數據。其集成的集線器支持符合標準的I^2C/I^3C通信用於模組內設備間通信，其溫度傳感幫助系統在重載下管理性能和穩定性。在DDR5中，我們的SPD芯片與模組上的PMIC和溫度傳感器協同工作，符合JEDEC的模組拓撲規範，從而在PC、服務器和AI平台上實現可靠的系統啟動、遙測和熱管理。

用於汽車電子及工業控制的高可靠性存儲類芯片

我們為汽車及工業控制設備中要求嚴苛的嵌入式系統設計並供應高可靠性非易失性存儲芯片。我們的產品組合以EEPROM為中心，適用於頻繁更新的小參數、標識符及日誌。我們的產品組合還包括NOR Flash，用於須快速及可預測讀取的可執行代碼及較大規模配置模塊。該等芯片專為長使用壽命、高數據完整性設計，且可在電氣噪音、電壓波動及頻繁掉電上電環境下穩定運行。

(i)　汽車電子

我們的車規級EEPROM涵蓋A1-A2系列，容量區間約從1 Kb至4 Mb。我們的車規級EEPROM支持I^2C、SPI（一種用於快速數據傳輸的高速串行接口）及Microwire（一種通常用於傳統汽車系統的更簡單串行接口）接口，並提供緊湊封裝以適應智能汽車空間受限的控制板。我們亦提供中低容量的車規級NOR Flash，主要覆蓋範圍為512 Kb至16 Mb，用以存儲安全關鍵與性能敏感的代碼。我們的汽車存儲芯片的設計、篩選及可靠性測試流程均遵循既定的汽車行業標準，且已完成AEC-Q100認證。

我們透過連續的項目定點與工藝改進持續推進。我們推出了A1-A2車規級EEPROM，並擴展了此領域多代存儲芯片產品的密度與接口。為滿足車輛使用壽命要求，我們亦提升了寫入耐久度與數據保存能力。截至2023年，我們所選定的EEPROM已完成AEC-Q100認證，並與一級供應商進入量產階段。

2024年，我們引進了可用於汽車座艙與車身的低密度車規級NOR Flash。此外，我們還製作了一款車規級NOR Flash，其主要用於ADAS系統和電力電子領域。

(ii)　工業控制

針對工業控制市場，我們的EEPROM產品覆蓋約1 Kb至4 Mb，我們的NOR Flash產品覆蓋512 Kb至64 Mb，未來預計將推出更高密度的產品，以支持自動化、能源與通信領域日益增長的固件映射需求。

我們開發此產品線，旨在使其廣泛應用於工廠自動化與通訊設備領域。2024年至2025年，我們已完成64 Mb更高密度工業級NOR Flash的流片與送樣，並正在開發其他密度產品以滿足自動化、數字能源及網絡領域中大型可無線更新固件的需求。

用於汽車電子及工業控制的高可靠性存儲芯片的關鍵特性與應用場景

我們的高可靠性存儲類芯片專為汽車電子及工業控制而設計，具有長壽命及在惡劣環境中表現穩定之優點，旨在保持數據完整、耐受噪聲與電源波動，並能適應高密度電路板與模組的空間要求。

EEPROM。我們設定在室溫下可實現數百萬次寫入週期，並在更高溫度下進行受控的降額使用。我們用於汽車電子及工業控制的EEPROM產品具備長數據保存時間、低靜態電流及緊湊封裝等特性，提供接口選項，包括I^2C、SPI與Microwire，並提供常見電壓與引腳數變體，以便直接替換與簡化認證。我們的車規級EEPROM涵蓋A1-A2系列，並持續在座艙、視覺感知、車身及動力系統項目中獲得客戶的認可。

NOR Flash。我們的NOR Flash產品可實現在室溫環境下擦除／編程100,000次及超過20年的標稱數據保持時間。我們NOR Flash的讀取性能支持快速隨機存取與就地執行，代碼可直接從閃存運行。我們的NOR Flash還經過ESD與閉鎖強化設計以應對高噪聲環境。

在所有該等存儲芯片產品中，我們持續改進我們的技術，以降低靜態功耗，並提升電磁與電氣穩健性，從而滿足不斷發展的汽車與工業標準。

用於汽車電子及工業控制的存儲芯片的應用場景包括但不限於：

- *座艙系統*。我們專為汽車電子及工業控制設計的高度可靠的存儲芯片在智能車輛的主要電子域中存儲配置、校準數據、日誌與代碼。在智能座艙內，儀表板、信息娛樂主機及抬頭顯示器使用我們的EEPROM，透過重複更新與電源循環保存調校數據、功能標誌與事件日誌。

- *ADAS與視覺感知*。攝像頭模組、毫米波雷達模組及激光雷達模組使用我們的EEPROM進行鏡頭與傳感器校準、模組識別及診斷，該等數據必須在車輛整個生命週期內保持準確。隨著智能車輛上傳感器數量與數據速率的不斷提升，我們的EEPROM耐用的參數存儲與快速代碼執行對於該等模組的穩定表現而言變得更為關鍵。

- *車身與底盤系統*。車身控制模組、電動助力轉向及集成制動系統在其使用壽命期間持續寫入與重寫參數、狀態及故障日誌。我們的EEPROM以高寫入耐久度與抗干擾能力支持該等頻繁更新，在啟動瞬變、電壓驟降及負載突降期間保護數據安全。

- *電動化動力系統*。電池管理系統、牽引逆變器、車載充電器及輔助控制器結合EEPROM用於配置與診斷。該等應用注重長數據保存時間、抗電磁干擾能力，以及在持續熱應力下的可靠表現。我們的存儲芯片產品能夠滿足整車廠認證流程及延長使用壽命的需求。

- *工業自動化*。我們的EEPROM應用於可編程邏輯控制器、伺服驅動器、機器人及工廠網關。工程師將識別碼、校準常數及現場日誌存儲於EEPROM中，其必須耐受頻繁更新與突發斷電。人機界面面板在顯示與觸控模組中使用EEPROM，以提供流暢的用戶界面及安全、可重複的固件更新，並維持多年穩定運行。

- *數字能源與電力電子*。在光伏逆變器、儲能系統、DC/DC與AC/DC變換器及電動汽車充電設備中，我們的EEPROM記錄配置參數及故障或事件日誌，其數據在電壓驟降、運行週期及電網干擾的情況下仍可保持完整。隨著該等平台增加更豐富的遙測與遠程管理功能，對更大容量代碼存儲與更頻繁參數更新的需求亦隨之增長。

- *通信基礎設施與光模組*。我們的EEPROM內存模組識別碼、數字診斷及校準數據，供主機系統讀取以進行監控與控制。光收發器與接入或聚合設備要求緊湊尺寸、低功耗及可預測的長期數據保存，我們針對高密度且受熱限制的線卡與模組，專門定制存儲芯片產品。

- *醫療設備與儀器*。製造商使用我們的EEPROM在其終端產品受監管的使用壽命內保存校準數據、設備識別碼及維護記錄。該等終端產品在受控但寬廣的溫度範圍與工作週期下運行，因此我們專注於數據完整性與讀取穩定性，以支持該等終端產品的長產品生命週期。

消費電子存儲類芯片

我們為消費電子終端產品提供廣泛的非易失性存儲芯片產品組合，專為滿足消費電子終端產品通常所需的緊湊型外觀與嚴苛功耗限制而設計。在該等系統中，我們的EEPROM用於存儲小型且頻繁更新的參數，例如校準數據、裝置識別碼、配對密鑰及生產記錄，並能在特定消費電子終端產品的使用壽命期間內，於斷電狀態下持續保存該等數據。我們提供支持I^2C、SPI及Microwire接口的EEPROM產品，容量範圍約1Kb至4Mb；並針對消費類應用開發低功耗SPI NOR Flash，容量涵蓋512 Kb至64 Mb。此外，我們通過ETOX技術提供更高存儲密度的SPI NOR Flash，具備數十至數百兆比特容量，以支持特定消費電子終端產品更大容量的固件。

我們於2011年成功進入一線手機供應商的攝像頭模組供應鏈，從而確立了在智能手機成像領域的早期領導地位。截至2016年，我們已成為該應用領域智能手機EEPROM的主要供應商。隨著消費電子終端產品對低功耗的需求日益增長，我們於2022年1月推出工作電壓為1.2 V的超低電壓智能手機EEPROM，並支持1.2 V與1.8 V I^2C電源軌的自動接口電壓識別功能，更獲選為一款領先智能手機品牌參考設計中的唯一EEPROM供應商。該項目定點加速了我們的存儲芯片產品在注重功耗的可穿戴設備及新興AI眼鏡領域的採用。

截至2024年，我們已躋身全球EEPROM供應商市場份額前列，並在智能手機攝像頭模組、LCD/AMOLED面板及藍牙模組領域佔據領先地位。2025年，我們持續優化存儲芯片產品以滿足特定消費電子終端產品的封裝小型化需求。此外，我們正開發基於ETOX技術的高容量SPI NOR Flash，以處理特定消費電子終端產品顯示器及聯網配件中較大的可無線更新固件映像。

消費電子存儲芯片的關鍵特性與應用場景

EEPROM。我們的消費EEPROM存儲芯片在室溫下可實現數百萬次擦寫，並在高溫環境下具備受控降額特性。產品具備長數據保存時間、低靜態電流等特性，並廣泛支持I^2C、SPI及Microwire接口。我們的存儲芯片產品提供的超低電壓選項可低至1.2 V，使系統能夠在顯著降低的電壓水平下運行，並支持I^2C接口在1.2 V至1.8V間的自動接口電壓適應功能，契合智能手機、手持雲台、穿戴式設備及AI眼鏡的功耗需求。消費EEPROM同時提供多種封裝選擇，以小型封裝的WLCSP為主。

NOR Flash。我們的消費級NOR Flash存儲芯片專注於低功耗SPI NOR，容量範圍從512 Kb至64 Mb不等。該等芯片具備快速隨機讀取功能，適用於就地執行固件；同時具備強大的ESD與閉鎖抗擾度，並延長標稱數據保存時間。

在商業應用層面，我們的消費存儲類芯片已廣泛應用於智能手機、顯示器、聯網模組等各類消費電子產品，實現量產規模。我們的消費存儲類芯片已獲可穿戴設備、手持雲台及AI相關設備採用。通過在AI消費電子終端產品領域贏得新的項目定點，我們持續深化消費存儲類芯片的市場滲透率，並在LCD、AMOLED面板及連接模組等成熟市場擴大份額，鞏固我們作為消費級非易失性存儲芯片領先供應商的地位。

我們消費電子存儲芯片的應用場景包括，但不限於：

- *智能手機與移動成像*。我們的EEPROM存儲芯片內置於攝像頭模組中，用於保存工廠校準參數、鏡頭ID及生產數據。該等資料會在設備開機時及使用過程中讀取，以確保影像質量長期穩定。此類芯片因具備高寫入耐受度（適用於頻繁更新）、長期數據保留及可靠讀取性能而被選用。我們消費存儲類芯片的超低電壓選項，能協助客戶在功耗敏感的產品設計中延長電池壽命。在相同的攝像頭組件中，設計師會根據需求將我們的EEPROM與攝像頭馬達驅動芯片搭配使用。

- *顯示系統*。顯示系統依賴快速穩定的隨機讀取，以實現快速啟動與流暢的用戶交互。此類系統通常搭配小容量EEPROM，用於存儲可於現場更新的配置與校準數據，同時確保資料的長期保留能力。這一組合廣泛應用於智能手機、平板電腦、顯示器及電視設備，並延伸至消費電子產品與小型家電中的嵌入式人機界面顯示屏。

- *連接與音頻配件*。在藍牙耳機、TWS耳機、Wi-Fi模組、智能音箱及條形音箱等產品中，我們的EEPROM用於存儲配對信息、校準常數及生產記錄等隨裝置使用週期而變化的數據。緊湊封裝與低待機電流是關鍵選型因素，我們提供符合此類消費電子終端產品尺寸與能源限制的解決方案。

- *可穿戴設備與AI眼鏡*。我們的超低電壓EEPROM有助延長電池壽命，並簡化可穿戴設備與AI眼鏡的電源軌設計。此類產品需具備長效數據保留能力，並在高負載循環下仍保持可預測的讀取行為，而我們的消費級存儲芯片正是為此需求量身打造。我們正擴展SPI NOR密度以容納更大的固件，同時保持低功耗。

- *其他消費電子與家電*。眾多消費電子終端產品的控制電路板採用EEPROM存儲參數、使用紀錄及服務資料，該等資料必須在斷電與維護週期中持續保存。我們的存儲芯片產品亦應用於電腦及特定物聯網裝置，滿足其對持久配置與緊湊代碼存儲的需求，包括打印機、PC周邊設備及家庭自動化節點等領域。

攝像頭馬達驅動芯片

攝像頭馬達驅動芯片是一種混合信號類芯片。其融合模擬與數字電路，以在數字控制下實現對物理系統的感知、驅動及控制。我們專注於攝像頭模組所使用的攝像頭馬達驅動芯片，以將電能轉化為小型致動器的精密運動。通過整合精密電流驅動、控制算法、傳感與校準技術，我們的攝像頭馬達驅動芯片在開環、閉環及光學防抖變體中均能實現穩定且可重複的定位。我們亦與客戶合作，將EEPROM與我們的攝像頭馬達驅動芯片整合於同一封裝中，用以存儲校準數據與參數，此舉可簡化客戶終端產品的模組設計。

我們逐步構建了這條產品線，實現了價值鏈的升級。早期開發的開環驅動芯片以緊湊封裝實現快速自動對焦功能，並助力建立我們的品牌。於2019年及2023年，多個系列開環攝像頭馬達驅動芯片入選市政創新目錄，彰顯了我們在此產品線的技術優勢。2023年推出的新一代開環驅動芯片具備兼容1.2V/1.8V邏輯電平自適應特性，可以自適應終端產品不同電壓需求。隨著此產品型號進入量產階段，我們的攝像頭馬達驅動芯片已獲得廣泛客戶認可，並實現強勁增長。與此同時，我們通過解決閉環控制、高精度模數轉換器設計及陀螺儀輔助穩定算法等關鍵技術難題，加速推進閉環與光學防抖驅動芯片的研發進程。在通過平台驗證後，我們已開始向領先智能手機製造商交付閉環與光學防抖驅動芯片。

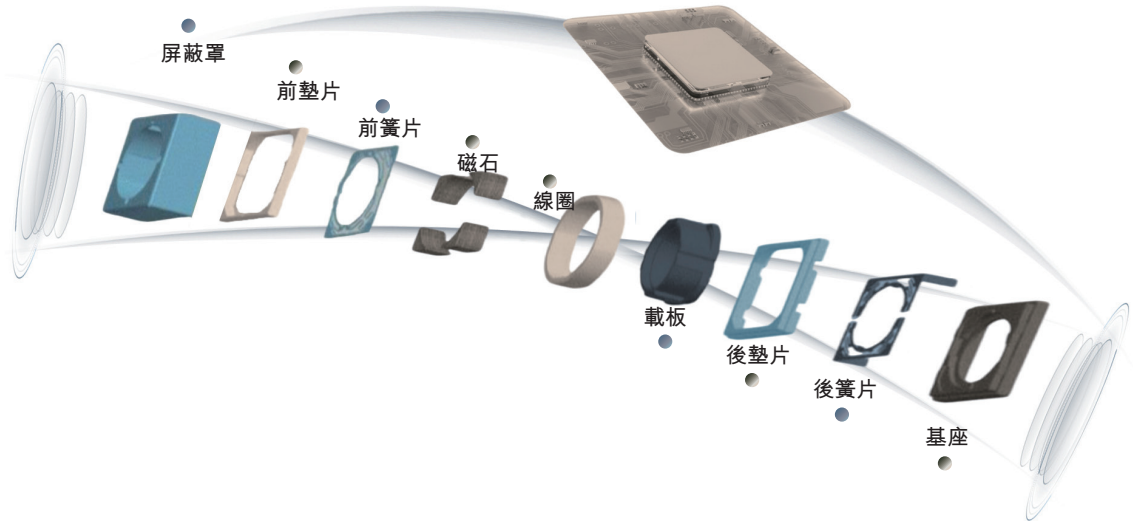
2024年期間，我們開始生產更多開環攝像頭馬達驅動芯片的衍生產品，包括驅動芯片與EEPROM的組合方案，並將閉環與光學防抖驅動芯片的驗證及試產出貨範圍擴展至中高檔機型。2025年，我們已向多家主流智能手機品牌出貨多款光學防抖驅動芯片，展現我們在該領域最高價值層級的攝像頭馬達驅動芯片開發與交付能力。我們計劃聚焦於擴大光學防抖驅動芯片的滲透率，進一步壓縮穩定化時間，優化陀螺輔助穩定算法，並持續縮小芯片尺寸與功耗，使元件能適用於更纖薄的攝像頭模組及高端潛望鏡模組。同時將持續推進驅動芯片與存儲整合技術，以顯著縮小模組體積並簡化校準流程。

攝像頭馬達驅動芯片的主要特性及應用場景

我們的開環攝像頭馬達驅動芯片採用阻尼感知算法、鏡頭參數自檢測及偏移電流自校準技術，實現快速穩態控制。此設計不僅提供迅捷自動對焦效能，更有效縮小模組尺寸並容許較大的馬達公差。部分系列的開環攝像頭馬達驅動芯片新增兼容1.2V/1.8V邏輯電平自適應功能，可以自適應終端產品不同電壓需求。

我們的閉環驅動芯片具備精密感測與更嚴密的控制機制，不僅提升準確度，更能確保智能手機及攝像頭等終端產品在溫度與功率變化間維持穩定性能。目前閉環驅動芯片正從客戶測試階段邁向更廣泛的應用。結合陀螺儀輔助穩定的光學防抖驅動芯片，現已應用於中高檔智能手機。隨著高端攝像頭模組將多軸穩定技術列為標準配備，預期我們的攝像頭馬達驅動芯片採用率將持續攀升。

我們專注於開發攝像頭馬達驅動芯片，實現快速鏡頭穩定功能——僅需不到一個致動器週期的時間即可完成定位，並具備更寬廣的致動器變異容差，使客戶能向多家供應商採購鏡頭。我們亦提供與我們的攝像頭馬達驅動芯片集成的內建存儲選項，例如EEPROM或片上NOR Flash，用於本地存儲校準與控制參數。我們致力提升攝像頭馬達驅動芯片的性能、穩定性與能源效率，同時保持其小尺寸，以適應薄型攝像頭模組及其他空間受限的應用場景。隨著鏡頭嵌入式移動裝置與聯網消費電子終端產品的普及，我們相信攝像頭馬達驅動芯片的市場滲透率將持續增長。



與攝像頭馬達驅動芯片配套的致動器組裝結構示意圖

應用場景包括，但不限於：

- *智能手機*。我們的攝像頭馬達驅動芯片為前後攝像頭模組提供自動對焦與防抖功能，從主流機型到旗艦手機皆能提升對焦速度、穩定性與影像銳利度。我們的開環驅動芯片用於高量產自動對焦通道，此類應用最重視快速穩定與低成本特性。針對需更快速穩定與高精度對焦控制的通道，他們選擇閉環驅動芯片；在中高端模組中採用光學防抖驅動芯片，以減少因手抖導致的照片與影片模糊。隨著多鏡頭陣列普及及前置鏡頭加入自動對焦功能，智能手機的鏡頭數量增加，對我們攝像頭馬達驅動芯片的需求預期也會隨之攀升。我們同時提供驅動芯片加EEPROM的解決方案，以縮小模組尺寸並簡化零件數量。

- *手持雲台*。攝像頭馬達驅動芯片提供精確的姿態控制與防抖功能，從入門級手機雲台到專業相機雲台皆能提升畫面流暢度、回應速度與運鏡穩定性。其中消費級輕量化雲台的應用重視低功耗、靜音與高性價比特性。隨著短視頻與Vlog創作普及，手持雲台對電機扭矩與回應精度的要求提高，對攝像頭馬達驅動芯片的需求預期也會隨之攀升。

- *其他緊湊型成像裝置*。製造商要求視頻會議終端、門禁與對講攝像頭，以及零售與物流環境中的掃描器或成像模組，均具備相同的鏡頭控制與穩定功能。該等終端產品重視在狹窄且受熱限制的環境中，實現快速穩定、低

噪音及鏡頭的長期穩定性能。我們優化算法，實現單次致動器循環內的影像穩定，並具備驅動頻率變異容忍度，僅需微調芯片參數設定即可相容多種攝像頭馬達驅動芯片。在平板電腦與消費級攝像頭領域，我們的閉環與光學防抖驅動芯片能於低光照環境及動態拍攝時提供更銳利的影像，滿足日常攝影與內容創作需求。

- *可穿戴設備與智能家居成像技術。*可穿戴設備與智能家居成像技術的空間與功耗極為有限，我們著重於小型封裝、低靜態功耗，以及驅動芯片與存儲整合技術，在保留光學元件空間的同時，確保自動對焦系統具備高速與高重複精準度。我們與模組製造商合作，共同優化機械堆疊結構與控制目標，使對焦與穩定功能能在超薄組件中快速穩定。

其他產品

除了非易失性存儲芯片與攝像頭馬達驅動芯片之外，我們更將非易失性存儲與混合信號技術的專業應用於識別與非接觸式通訊領域。此類產品的主力為NFC芯片。

NFC芯片

我們的NFC芯片專為廣泛互通性與實用安全性而設計。其遵循NFC論壇制定的芯片規範及通用ISO/IEC近距離通訊標準，可與智能手機及大眾市場IC讀卡器無縫運作。芯片結合高靈敏度射頻前端（具備節能特性並維持穩定連線）與防碰撞機制，使多個電子標籤得以無干擾讀取。NFC芯片內嵌的非易失性存儲可存儲固定識別碼與應用資料，客戶可通過現場更新進行配置、功能啟用及售後支持，並具備密碼保護、鎖位比特及選配驗證等多重防護機制。NFC芯片經低功耗調校，在固定天線尺寸下可實現更遠距離的穩定讀取，並能跨越製造與環境變異維持一致性能，確保大規模部署時行為可預測。在產品組合中，我們致力於縮小芯片面積、提升射頻靈敏度、優化存儲架構以加速讀寫速度，並擴展封裝選項，使產品能更簡便地整合至空間受限的產品與標籤中。

應用場景包括，但不限於：

- *電子價簽。*我們的NFC芯片整合於電子價簽中，支持快速裝置初始化、免電池電子墨水刷新及互動式消費者行銷。內置存儲用於儲存商品編號識別碼、配置參數與動態促銷連結，確保零售數據即時更新與可追溯性。即使在高密度環境中，我們的NFC芯片仍能提供快速穩定的讀寫效能。

- *消費電子產品與智能家居裝置。*製造商將我們的NFC芯片嵌入產品，實現輕觸配對與輕觸設定的操作體驗。終端使用者只需將智能手機靠近揚聲器、耳機、電視、機頂盒或家庭自動化節點，即可完成安全配對、配置Wi-Fi憑證或啟動引導式設定。嵌入電子標籤的NFC芯片存儲配置資料、裝置識別碼及服務連結，該等信息無需電源即可長久保存，並能在後續安裝或維護時進行更新。

- *大型家電與小型家用設備。*我們的NFC芯片能簡化設備啟用流程與售後服務。技術人員與終端使用者只需輕觸家電，即可讀取標籤存儲中存儲的型號、序列號、安裝參數、診斷資料及維護紀錄。由於標籤無需電池供電，不僅大幅降低成本，更能為終端產品提供全生命週期的技術支持。

- *包裝、配件與品牌互動*。我們的NFC芯片支持防偽驗證、互動式產品信息、電子價籤動態價格更新及售後服務。NFC芯片內存儲的行銷數據可於終端產品整個生命週期內持續存取。我們正致力優化小型天線與特殊安裝位置的射頻靈敏度，使標籤能整合至標籤紙、紙箱、精巧配件及電子價籤中，同時維持讀取可靠性。

- *輕工業與設施應用*。客戶將我們的NFC芯片用於資產識別、配置交接及維護記錄等場景，此類應用偏好短距離且需主動讀取的特性。現場人員只需輕觸工具、固定裝置或已安裝設備，即可在無需啟動主系統電源的情況下，讀取或更新芯片存儲中的配置與服務資料。我們的NFC芯片具備強大的數據保留能力，並符合通用標準，使其能輕鬆搭配市售移動裝置或常見IC讀卡器使用。

我們的主要運營及財務數據

我們提供涵蓋高端、中端和低端市場的廣泛產品，包括標準化產品和高度定制化解決方案。於往績記錄期間，我們產品的單價因應用場景而異：(i)存儲模組配套芯片的價格區間為人民幣0.3元以下至人民幣12.3元；(ii)用於汽車電子及工業控制的芯片價格區間為人民幣0.2元以下至人民幣8.8元；(iii)消費電子芯片的價格區間為人民幣0.1元以下至人民幣3.9元；(iv)攝像頭馬達驅動芯片的價格區間為人民幣0.2元以下至人民幣9.1元；及(v) NFC芯片的價格區間為人民幣0.1元以下至人民幣2.2元。每種產品的價格因多種因素而異，例如：(i)所售產品的類型；(ii)產品應用的行業領域；(iii)客戶訂購的產品數量；(iv)本公司與客戶之間先前已建立的業務關係；(v)客戶的預期支出預算；以及(vi)半導體行業的整體市場供應／需求及競爭格局，以及由此產生的週期性波動。

下表載列我們於往績記錄期間三大主要業務線的收入明細（按金額及佔總收入的百分比列示）：

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	人民幣	*%*	*人民幣*	*%*	*人民幣*	*%*	*人民幣*	*%*	*人民幣*	*%*
					(以千元計，百分比除外)		*(未經審核)*			
非易失性存儲芯片[1].....	561,688	79.8	885,989	86.2	1,069,499	87.6	232,069	88.9	247,512	88.4
攝像頭馬達驅動芯片	87,163	12.4	105,010	10.2	113,922	9.3	21,345	8.2	16,619	5.9
NFC芯片及其他[2].....	54,626	7.8	37,278	3.6	37,863	3.1	7,652	2.9	15,863	5.7
總計	**703,477**	**100.0**	**1,028,277**	**100.0**	**1,221,284**	**100.0**	**261,066**	**100.0**	**279,994**	**100.0**

附註：

(1) 包括以DDR內存模組中的SPD芯片為亮點的存儲模組配套芯片、汽車電子與工業控制用高可靠性存儲類芯片及消費電子用存儲類芯片。

(2) 其他產品主要包括2023年的PMIC及TS芯片，及2025年及2026年第一季度的邏輯芯片及TS芯片。此處包括的TS芯片的應用場景不包括存儲模組。

下表載列所示年度／期間按單個產品線芯片數量劃分的產品出貨量：

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	出貨量	平均售價 *(人民幣元)*	出貨量	平均售價 *(人民幣元)*	出貨量	平均售價 *(人民幣元)*	出貨量	平均售價 *(人民幣元)*	出貨量	平均售價 *(人民幣元)*
非易失性存儲芯片[1]	1,631,496,546	0.34	2,374,000,980	0.37	2,723,876,383	0.39	538,315,930	0.43	861,982,659	0.29
攝像頭馬達驅動芯片	414,697,215	0.21	552,381,200	0.19	586,292,000	0.19	121,750,500	0.18	84,508,000	0.20
NFC芯片及其他[2]	385,641,444	0.14	386,359,130	0.10	474,335,962	0.08	91,415,507	0.08	134,162,313	0.12

附註：

(1) 包括以DDR內存模組中的SPD芯片為亮點的存儲模組配套芯片、汽車電子與工業控制用高可靠性存儲類芯片及消費電子用存儲類芯片。

(2) 其他產品主要包括2023年的PMIC及TS芯片，及2025年及2026年第一季度的邏輯芯片及TS芯片。此處包括的TS芯片的應用場景不包括存儲模組。

由2023年至2025年，三大業務線的出貨量均錄得持續增長。非易失性存儲芯片錄得最強勁增長，主要是由於我們在SPD芯片、車規級存儲芯片及工業級存儲芯片的銷售增加。攝像頭馬達驅動芯片的出貨量亦大幅增加，主要受智能手機市場需求復甦的推動。NFC芯片及其他產品的出貨量保持相對穩定。於截至2025年及2026年3月31日止三個月期間，非易失性存儲芯片以及NFC芯片及其他產品的出貨量持續錄得強勁增長，而攝像頭馬達驅動芯片的出貨量則有所下降。

由2023年至2025年，儘管我們面臨定價壓力，但我們的非易失性存儲芯片的平均售價持續提升。非易失性存儲芯片的平均售價增加主要由於有利的產品組合轉向高附加值應用所致。攝像頭馬達驅動芯片的平均售價於2023年至2025年期間維持相對穩定。我們的NFC芯片及其他產品的平均售價略微下降，主要由於智能卡及相關應用市場的復甦弱於預期以及我們於此期間提供的產品組合較不理想。於截至2025年及2026年3月31日止三個月期間，非易失性存儲芯片的平均售價錄得輕微下降，主要由於我們因應下游市場逆風而銷售的產品組合發生變動。攝像頭馬達驅動芯片的平均售價錄得溫和增長。NFC芯片及其他產品的平均售價有所上升，主要由於隨著我們拓展至新應用場景，利潤率較高的NFC芯片的貢獻增加。

我們通過與晶圓廠及OSAT供應商建立長期合作夥伴關係，不斷加強我們的價值鏈競爭力。隨著我們提高在成熟市場的滲透率及推出高性能新產品，我們拓展了銷售及市場地位，增強了我們與供應商的議價能力。

下表載列所示年度／期間按應用場景劃分的收入明細：

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	人民幣	*%*	*人民幣*	*%*	*人民幣*	*%*	*人民幣*	*%*	*人民幣*	*%*
					(以千元計，百分比除外)		*(未經審核)*			
非易失性存儲芯片	**561,687**	**79.8**	**885,990**	**86.2**	**1,069,499**	**87.6**	**232,069**	**88.9**	**247,512**	**88.4**
存儲模組配套芯片[1]	193,033	27.4	385,643	37.5	477,698	39.1	110,980	42.5	79,730	28.5
汽車電子及工業控制	74,463	10.6	153,865	15.0	255,010	20.9	48,759	18.7	63,549	22.7
消費電子	270,503	38.5	318,441	31.0	296,243	24.3	64,307	24.6	86,383	30.9
其他[2]	23,687	3.4	28,041	2.7	40,548	3.3	8,023	3.1	17,850	6.5
攝像頭馬達驅動芯片	**87,163**	**12.4**	**105,010**	**10.2**	**113,922**	**9.3**	**21,345**	**8.2**	**16,619**	**5.9**
NFC芯片及其他[3]	**54,626**	**7.8**	**37,278**	**3.6**	**37,863**	**3.1**	**7,652**	**2.9**	**15,863**	**5.7**
總計	**703,477**	**100.0**	**1,028,277**	**100.0**	**1,221,284**	**100.0**	**261,066**	**100.0**	**279,994**	**100.0**

附註：

(1) 主要包括SPD芯片、VPD芯片及TS芯片。

(2) 指跨場景使用的通用存儲芯片。

(3) 其他主要包括2023年的PMIC及TS芯片，以及2025年及2026年第一季度的邏輯芯片及TS芯片。此處包括的TS芯片的應用場景不包括存儲模組。

由2023年至2025年，人工智能應用、智能交通及汽車整車廠在國內採購的上升趨勢以及工業控制應用需求不斷增長，支持我們在主要下游應用場景中的收入持續增長。於截至2025年及2026年3月31日止三個月期間，來自存儲模組配套芯片的收入減少，主要由於封裝DRAM及NAND芯片供應緊張及價格上漲壓力導致的下游市場波動所致，而來自我們其他應用場景的收入則錄得持續增長。

下表載列所示年度／期間按產品類型劃分的收入明細：

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	人民幣	*%*	*人民幣*	*%*	*人民幣*	*%*	*人民幣*	*%*	*人民幣*	*%*
					(以千元計，百分比除外)		*(未經審核)*			
非易失性存儲芯片	**561,687**	**79.8**	**885,990**	**86.2**	**1,069,499**	**87.6**	**232,069**	**88.9**	**247,512**	**88.4**
SPD芯片	193,033	27.4	385,506	37.5	475,987	39.0	110,108	42.2	78,924	28.2

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	人民幣	*%*	*人民幣*	*%*	*人民幣*	*%*	*人民幣*	*%*	*人民幣*	*%*
					(以千元計，百分比除外)		*(未經審核)*			
VPD芯片	-	-	136	0.0	1,125	0.1	816	0.3	–	–
TS芯片	-	-	-	-	586	0.0	57	–	807	0.3
EEPROM	350,405	49.8	423,551	41.2	473,792	38.8	105,465	40.4	108,114	38.6
NOR Flash	18,249	2.6	76,796	7.5	118,009	9.7	15,623	6.0	59,667	21.3
攝像頭馬達驅動芯片	**87,163**	**12.4**	**105,010**	**10.2**	**113,922**	**9.3**	**21,345**	**8.2**	**16,619**	**5.9**
NFC芯片及其他(1)	**54,626**	**7.8**	**37,278**	**3.6**	**37,863**	**3.1**	**7,652**	**2.9**	**15,863**	**5.7**
總計	**703,477**	**100.0**	**1,028,277**	**100.0**	**1,221,284**	**100.0**	**261,066**	**100.0**	**279,994**	**100.0**

附註：

(1) 其他主要包括2023年的PMIC及TS芯片，以及2025年及2026年第一季度的邏輯芯片及TS芯片。此處包括的TS芯片的應用場景不包括存儲模組。

由2023年至2025年，來自SPD芯片的收入顯著增加，主要是由於DDR5快速滲透及我們及時推出符合DDR5標準的SPD。於2026年第一季度，來自SPD芯片的收入有所減少，主要由於封裝DRAM及NAND芯片供應緊張及價格上漲壓力導致的下游市場波動所致。與2025年同期相比，來自EEPROM的收入由2023年至2025年及於2026年第一季度穩步增長，主要受汽車及工業控制應用需求增加所推動。來自NOR Flash的收入由2023年至2025年顯著增加，主要受汽車及工業控制應用需求所推動，且與2025年同期相比，該收入於2026年第一季度繼續增加，主要歸因於我們在消費電子行業的市場份額持續增加，以及我們獲得了國際領先汽車品牌的可觀訂單。

由2023年至2025年，我們的攝像頭馬達驅動芯片收入持續增長，主要受我們產品在高端智能手機中更深入的滲透所推動。而與2025年同期相比，2026年第一季度的收入有所減少，因為整體智能手機市場面臨壓力。來自NFC芯片的收入於2023年至2024年輕微下降，於2025年保持相對穩定，並於2026年第一季度錄得強勁增長，主要受我們拓展至對利潤率較高的NFC芯片產品有需求的新應用場景所帶動。

下表載列所示年度／期間按銷售渠道劃分的收入明細：

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	人民幣	*%*	*人民幣*	*%*	*人民幣*	*%*	*人民幣*	*%*	*人民幣*	*%*
					(以千元計，百分比除外)		*(未經審核)*			
直銷	220,064	31.3	473,394	46.0	593,772	48.6	140,753	53.9	111,303	39.8
分銷	483,413	68.7	554,883	54.0	627,512	51.4	120,313	46.1	168,691	60.2
總計	**703,477**	**100.0**	**1,028,277**	**100.0**	**1,221,284**	**100.0**	**261,066**	**100.0**	**279,994**	**100.0**

由2023年至2025年，我們的兩個銷售渠道的收入均錄得持續增長，主要受我們非易失性存儲芯片（尤其是SPD芯片、車規級存儲芯片及工業級存儲芯片）的強勁增長所推動。於截至2026年3月31日止三個月，我們的直銷收入較2025年同期有所減少，主要由於主要通過直銷銷售的SPD芯片的銷售額下降。我們的經銷收入於同期有所增加，主要由於主要通過分銷商銷售的車規級芯片、工業級存儲芯片及NFC芯片的銷售額增加。

下表載列所示年度／期間我們按地區劃分的收入明細：

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	人民幣	*%*	*人民幣*	*%*	*人民幣*	*%*	*人民幣*	*%*	*人民幣*	*%*
					(以千元計，百分比除外)		*(未經審核)*			
中國內地[1]	379,027	53.9	468,877	45.6	567,605	46.5	107,988	41.4	151,716	54.2
澳門、香港及台灣[1]	260,674	37.1	465,170	45.2	579,046	47.4	132,849	50.9	110,582	39.5
韓國[1]	40,486	5.8	66,655	6.5	48,362	4.0	14,359	5.5	9,390	3.4
其他國家／地區[1][2]	23,290	3.2	27,575	2.7	26,271	2.1	5,870	2.2	8,306	3.0
總計	**703,477**	**100.0**	**1,028,277**	**100.0**	**1,221,284**	**100.0**	**261,066**	**100.0**	**279,994**	**100.0**

附註：

(1) 我們按地域報告的收入是基於客戶註冊成立的地點。

(2) 包括越南、美國、新加坡、德國、日本、泰國、以色列、菲律賓及印尼。

由2023年至2025年，大多數地區的收入均實現持續增長。於期內，來自澳門、香港及台灣地區的收入增長較快，主要是由於該地區主要客戶的強勁需求以及我們在高增長的人工智能、汽車及工業控制應用領域的成功市場滲透。截至2026年3月31日止三個月，與2025年同期相比，來自中國內地的收入保持增長勢頭，而來自澳門、香港及台灣的收入則有所下降，由於期內SPD芯片的交付量下降。

我們的技術

我們的技術平台建立在非易失性存儲技術之上，並融合了(i)先進的混合信號電路設計，可同時處理現實世界的模擬信號及數字數據，(ii)跨工藝製造協作，這涉及從一開始就整合多樣化、多學科的團隊（如設計、工程和製造），以打破職能孤島，及(iii)嚴格的器件級認證能力，確保特定、完整的產品在上市前符合強制性的安全、安保及技術行業標準。我們將這些能力應用於非易失性存儲芯片—DDR模組用SPD芯片、EEPROM及NOR Flash、攝像頭馬達驅動芯片以及NFC芯片。我們技術開發的重點是長期數據完整性、低功耗、緊湊的晶粒尺寸以及在擴展溫度範圍內的穩健運行。

核心非易失性存儲芯片設計及工藝平台

我們的非易失性存儲技術目標是高耐久性、長保持期、低電源電壓及緊湊陣列，採用高效、連續的內存結構。我們開發了電路及陣列技術，以提高寫入循環能力、減少洩漏及電荷損失，並穩定寫入／擦除行為。在EEPROM方面，我們保持從約1 Kb到4 Mb的全範圍I^2C/SPI/Microwire接口，並提供適合功耗敏感型移動及可穿戴設計的超低電壓選項。

下表概述了所披露的選定非易失性存儲技術（適用於EEPROM及NOR Flash）及代表性參數。

技術領域	具體技術／特性	代表性參數／數值	效益／影響	狀態／IP覆蓋
電荷處理及可靠性	高效電荷泵；寫入／擦除斜率控制，在線糾錯	穩定的寫入／擦除行為，數據完整性提升（定性）	在頻繁更新期間具有更高耐久性及更低錯誤率	生產中，由內部專業知識及專利覆蓋
陣列／晶粒效率	緊湊型解碼器架構，Y解碼器讀寫復用，「無字節選擇晶體管」佈局	特定密度下更小的晶粒（定性）	每比特成本更低，封裝更小	生產中
低電壓運行	超低電壓非易失性存儲運行，I^2C接口電壓自動識別	選定EEPROM在1.2 V下運行，1.2/1.8 V自動識別	延長電池壽命，簡化系統設計	生產中（1.2 V智能手機EEPROM）
耐久性及保持期（EEPROM）	陣列／單元壽命調優	高達數百萬次寫入循環，室溫下長保持期（選定器件）	無數據丟失的頻繁小量更新	生產中

SPD芯片技術

DDR5模組要求每個DIMM配備一個SPD芯片。我們的DDR5 SPD集成三個功能模塊：內存模組身份及配置的EEPROM、協調模組上組件之間邊帶總線的I^2C/I^3C集線器，以及位於SPD位置的高精度溫度傳感器。

下表載列我們DDR模組中SPD芯片的關鍵技術差異化因素概要。

功能模塊	接口及容量	代表性參數／數值	模組上的作用	效益／影響	狀態
EEPROM	I^2C/I^3C、8 Kb	模組數據的非易失性存儲	用於系統啟動的模組身份／配置	可靠初始化，符合標準	量產中

功能模塊	接口及容量	代表性參數／數值	模組上的作用	效益／影響	狀態
I^2C/I^3C集線器.....	I^2C/I^3C	符合JEDEC定義的DDR5 DIMM上的I^2C/I^3C管理通道	協調受管器件之間的低速通信	簡化系統控制拓撲結構	量產中
溫度傳感.....	I^2C/I^3C	寬溫度範圍內的高精度傳感，符合JEDEC DDR5模組標準	SPD位置的本地溫度遙測	支持熱管理及降額	量產中

攝像頭馬達驅動控制及精密模擬

我們的攝像頭馬達驅動技術涵蓋開環、閉環及OIS。開環驅動芯片在無反饋的情況下為自動對焦提供快速、精確的電流控制；閉環驅動芯片增加了高精度傳感及控制，以實時精細調整鏡頭定位。OIS器件集成基於陀螺儀的穩定技術與閉環控制算法，用以抵消抖動導致的模糊。

下表載列我們選定的鏡頭控制及模擬技術概要。

控制／模擬模塊	具體技術／特性	代表性參數／數值	應用產品	效益／影響	狀態
電流驅動及建立..	快速穩定算法，阻尼感知控制	快速鏡頭穩定，低位置誤差(定性)	開環，閉環；OIS	更快的自動對焦；減少模糊	量產中(開環)，已驗證／爬坡中(閉環)，出貨中(OIS)
校準及公差處理..	鏡頭參數自檢測，偏置電流自校準	自動參數適配(定性)	開環，閉環；OIS	跨致動器公差／溫度的性能一致性	生產中(選定型號)
精密傳感及控制.....	用於位置反饋的高分辨率ADC及低噪音PGA	高精度轉換(定性)	閉環，OIS	準確及快速的鏡頭定位	生產／驗證中
OIS控制.....	基於陀螺儀的防抖	集成陀螺儀輸入及控制(定性)	OIS驅動芯片	拍攝過程中的運動補償	自2025年起商業出貨

研發

截至2026年3月31日，我們共有196名從事研發的全職僱員。於2023年、2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月，我們的研發開支分別為人民幣160.8百萬元、人民幣175.6百萬元、人民幣207.8百萬元及人民幣66.7百萬元。

我們的研發計劃專注於開發我們的核心非易失性存儲及混合信號技術。我們的研發團隊涵蓋電路設計、模擬及混合信號、固件及算法、產品工程、可靠性及應用支持。

我們研發工作的首要任務是鞏固我們在DDR5模組SPD芯片領域的地位。我們的DDR5 SPD結合了EEPROM、I^2C/I^3C集線器及溫度傳感器，我們也供應用於諸多伺服器DIMM的獨立式溫度傳感器。我們繼續將我們的SPD芯片應用於更多計算機內存模組形態，這些形態主要以物理尺寸及應用區分，如UDIMM、SODIMM、CAMM/CAMM2、LPCAMM/LPCAMM2、SOCAMM/SOCAMM2、RDIMM、LRDIMM及MRDIMM。

在EEPROM方面，我們正在開發用於工業及汽車用途的晶粒更小、可靠性更高的器件，其中車規級系列涵蓋A1-A2。在NOR Flash方面，我們專注於中低容量的低功耗產品。我們512 Kb至32 Mb的NOR Flash正在量產中，64 Mb及128 Mb的產品已經流片，更高密度的產品正在開發中。對於選定的低容量器件，我們在室溫環境下實現了編程／擦寫次數100,000次和標稱數據保持時間超過20年，且512 Kb至16 Mb系列的部分產品已完成AEC-Q100驗證。

此外，我們正在推動我們的攝像頭馬達驅動芯片組合向更高價值領域移動。我們繼續改進用於大批量攝像頭模組的開環馬達驅動芯片。我們已將集成高精度傳感功能的閉環馬達驅動芯片從驗證階段推進至部署階段。2025年，多款OIS驅動芯片開始在中高端智能手機上商業出貨。

此外，我們持續升級我們的NFC產品。我們正在減小晶粒面積，提高讀／寫速度及射頻靈敏度，並向更高價值的CPU卡及更廣泛的RFID/NFC產品組合擴展，例如公共交通、門禁控制及身份識別、校園卡、智能儀表、電子價簽、新零售及供應鏈管理，同時保持符合ISO/IEC 14443及15693標準並支持標準加密算法。

值得注意的是，於2023年，我們開始開發用於新一代企業級SSD及CXL內存模組的VPD芯片，以將我們的模組管理專業知識擴展至DRAM模組以外的領域。截至最後實際可行日期，VPD芯片已順利通過目標客戶的測試認證，並將搭載在目標客戶的模組樣品上，分發給各終端客戶進行進一步測試驗證。

下表載列我們的主要研發項目及其進度。

產品	目前開發進展	研發重點／關鍵亮點	具體應用前景	預期商業化時間表
存儲模組配套芯片（SPD芯片，VPD芯片和溫度傳感器）.....	若干規格產品已完成流片，處於改版優化階段。	嚴格遵循行業組織標準規範，高可靠性，可在寬溫度範圍內實現高測量精度。	服務器和個人電腦領域的存儲模組。	2026年
工業級EEPROM芯片.....	若干規格產品已量產；部分規格產品已完成改版優化，處於產品測試階段；部分規格產品已完成流片，處於工程樣品測試階段。	基於更小存儲單元設計，擬開發覆蓋多個存儲容量的EEPROM芯片，降低生產設計成本，並進一步增強功能和可靠性。	智能手機、平板電腦、物聯網等消費電子市場，以及工業控制、通訊、醫療儀器。	2026年至2027年

產品	目前開發進展	研發重點／關鍵亮點	具體應用前景	預期商業化時間表
汽車級EEPROM芯片	若干規格產品已完成流片，處於工程樣品測試階段；部分規格產品處於電路設計階段。	擬開發多款不同容量的汽車級EEPROM芯片。部分規格產品基於滿足ISO 26262汽車功能安全標準設計，可實現最高125℃的工作溫度；部分規格產品存儲密度較市場主流產品提升兩倍。	汽車電子領域，以及對空間有嚴苛要求的移動應用或工業控制市場。	2027年至2028年
NOR Flash	若干規格產品已量產；部分規格產品已完成改版優化，處於產品測試階段；部分規格產品已完成流片，處於工程樣品測試階段；部分規格產品處於流片階段；部分規格產品處於電路設計階段。	擬開發覆蓋多個中低存儲容量的NOR Flash芯片，部分產品具有更可靠的性能和更強的溫度適應能力，耐擦寫次數高達20萬次，數據保持時間長達50年，適應的溫度範圍為-40℃-125℃，並具備更優秀的功耗、數據傳輸速度、ESD及閉鎖性能。	消費電子、汽車電子等領域，以及對應用環境有嚴苛要求的工業控制和對低延遲低功耗有嚴格要求的物聯網等應用市場。	2026年至2029年
攝像頭馬達驅動芯片	若干規格產品已量產或已準備導入量產；部分規格產品已完成流片，處於工程樣品測試階段；部分規格產品處於電路設計階段。	擬開發多個規格的攝像頭馬達驅動芯片，包括新一代兼容1.2V/1.8V的開環式攝像頭馬達驅動芯片以及閉環式與光學防抖(OIS)式攝像頭馬達驅動芯片產品。部分規格產品集成EEPROM或高容量Flash，並進一步提升驅動能力和精度、縮短穩定時間等關鍵性能指標。	智能手機、平板電腦、安防監控設備、手持雲台等影像相關領域。	2026年至2027年
NFC芯片及其他	若干規格產品已量產；部分規格產品已完成客戶端驗證，處於改版優化階段；部分規格產品處於流片階段；部分規格產品處於電路設計階段。	擬開發多個規格的NFC芯片和邏輯運算類芯片，其中NFC芯片符合NFC Forum標準規範，並支持ISO/IEC通信協議，在提高可靠性的同時，進一步優化芯片面積和功耗，提升射頻靈敏度，更好滿足讀寫距離要求。	電子價簽、消費電子產品與智能家居裝置、大型家電與小型家用設備、包裝配件與品牌互動、輕工業與設施應用等領域；邏輯運算類芯片主要應用於消費電子等領域。	2026年

製造及質量保證

我們是一家無晶圓廠公司。我們將晶圓製造外包予晶圓代工廠，並將大批量封裝及最終電性測試外包予OSAT合作夥伴。同時，我們在內部保留關鍵的質量及測試職責。這種模式使我們能夠與值得信賴的合作夥伴一起擴大生產規模，同時控制產品的驗證、篩選及向客戶放行的過程。

與此模式及我們的銷售渠道一致，我們向分銷商或直接向模組廠商及終端品牌廠商供貨；此外，我們的車規級芯片已獲得多家全球一級供應商的認證，可用於領先汽車製造商平台及其他終端系統。我們的質量管理及發佈流程旨在滿足該等汽車終端產品及相關製造商的特定要求，包括針對汽車項目的第三方可靠性認證。

我們設有內部產品測試部門，負責在任何產品進入量產前主導工程驗證及試產檢查。利用早期晶圓，我們根據規格測試及評估器件性能、可靠性及裕量。在產能爬坡前，我們運行嚴格的試產批次，並僅在結果符合我們的放行標準時才繼續進行。對於量產，我們開發、驗證並擁有針測及最終測試程序以及任何額外的出貨篩選程序。

我們規劃並執行符合適用行業慣例的器件認證，對於車規級產品，我們支持第三方的AEC-Q100驗證。倘可靠性數據或現場經驗顯示潛在的失效模式，我們會增加針對性的測試項目，以便在出貨前攔截該模式。我們亦與供應商及客戶共同主導失效分析及糾正措施，將發現反饋到設計規則、工藝窗口及篩選內容中以防止復發。這些措施－工程驗證、試產檢查、測試程序確認、增強的出貨篩選及嚴格的放行－構成了我們自行執行的質量檢查核心，儘管制造環節是外包的。

截至最後實際可行日期，我們擁有以下認證：

類別	範圍／狀態
ISO 9001.....	涵蓋設計及相關流程的經認證質量管理體系
IATF 16949	經認證的汽車質量管理體系；應用於汽車器件供應
ISO 14001.....	經認證的環境管理體系
AEC-Q100	選定器件已獲驗證（例如：EEPROM A1-A2等級；部分512 Kb-16 Mb NOR）
ISO 26262.....	針對目標車規級EEPROM規格參考的設計規範

存貨管理

我們定期監控現有存貨數量，並主要根據歷史使用率及我們對產品的未來需求預測，為過剩及滯銷存貨記錄撥備。在設定存貨週轉目標時，我們亦會考慮公共關係環境、政治發展、宏觀經濟趨勢及終端市場狀況。我們致力控制存貨水平，以免在每個財政季度末持有超出需求的存貨。

於2023年、2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月，我們的存貨週轉天數分別為252天、226天、238天及241天。為提高存貨效率，我們採用了統一的倉儲

和配送系統，並持續提升存貨週轉率。我們在訂單執行、供應鏈管理和高效交付方面建立了強大的能力。透過滾動預測以及將需求轉化為確定的生產與採購計劃的明確規則，我們採用與銷售與製造保持一致的一體化銷售與運營計劃流程。

我們採用了企業對企業的電子數據交換，使我們能夠管理存貨並促進向供應商發出訂單請求。透過分析交易活動，供應商獲得改進的需求計劃，這使我們能夠做出合理的預測並維持高效的製造或採購流程。憑藉協同規劃、預測及補貨模式、訂單可視化及其他功能，我們能以更低成本提高產品訂單的執行及交付效率，使我們處於更有利位置，以維持最佳存貨水平並及時滿足市場需求。

供應鏈管理

我們建立了涵蓋供應商導入、審批及其他流程的結構化供應鏈管理體系，並致力於持續完善該體系。在供應商導入階段，我們對供應商進行初步審查。此後，新供應商還需通過質量體系調查及現場審核，並簽署質量協議。經生產管理部門、質量部門及其他部門審核批准後，方可列入我們的合格供應商名單。

我們已制定並持續優化供應商質量管理程序。我們按固定頻率對供應商進行審核，並採取定期評估及季度質量會議等供應商管理措施，持續提升供應商的質量管理水平。我們每季度對合格供應商進行質量保證、工藝技術、產能、交期與服務、價格、環保等方面的評估。此外，我們每年制定年度審核計劃，對供應商進行深入的現場審核。沒有收到滿意審核結果的供應商，須根據審核結果制定改進計劃，並在規定期限內實施。此外，我們還派專人進行現場檢查，監督供應商的生產過程、質量控制體系及環保措施。所有供應審核及整改事項記錄均錄入供應管理系統並進行跟進直至完結，形成閉環管理，確保供應鏈高效穩定運行。

我們的客戶

於往績記錄期間，我們的主要客戶包括國內外領先的模組廠商及終端品牌廠商，以及主要從事電子元件、半導體及模組電路分銷及銷售的公司。我們在技術領先地位、設計創新、產品性能、成本效益及準時交付方面的良好往績記錄，奠定了我們在提供存儲類芯片產品及解決方案方面的領先地位。我們相信，我們與模組廠商及終端品牌廠商客戶(其中許多目前也在開發專注於我們多個目標市場的解決方案)的牢固關係，將繼續使我們成為其產品供應的來源。按照市場慣例，我們使用分銷商以促進我們產品的銷售。

模組廠商及終端品牌廠商及其合作夥伴均可溝通設計要求及技術規範、協商價格，並就其產品中使用我們的半導體解決方案作出整體決定。我們的客戶向我們下達購買產品的訂單，並在簽收後獲得所購產品的所有權。除保修條款外，該等客戶大多無退貨權。

下表載列往績記錄期間各年度／期間我們五大客戶的背景資料。

客戶	收入	佔總收入百分比	向我們採購的主要產品／服務	業務關係開始年份	信用期
	(人民幣千元)				
截至2026年3月31日止三個月					
1. 客戶A[1].....	74,793.1	26.7%	存儲模組配套芯片	2018年	30天
2. 客戶B[2].....	16,314.0	5.8%	存儲模組配套芯片、用於汽車電子及工業控制的高可靠性存儲芯片、用於消費電子領域的存儲芯片／攝像頭馬達驅動芯片／NFC芯片	2023年	45天
3. 客戶C[3].....	11,479.5	4.1%	用於汽車電子及工業控制的高可靠性存儲芯片、用於消費電子領域的存儲芯片／攝像頭馬達驅動芯片／NFC芯片	2021年	60天
4. 客戶D[4].....	10,897.6	3.9%	存儲模組配套芯片、用於汽車電子及工業控制的高可靠性存儲芯片、用於消費電子領域的存儲芯片／NFC芯片	2017年	30天
5. 客戶E[5].....	8,755.7	3.1%	存儲模組配套芯片、用於汽車電子及工業控制的高可靠性存儲芯片、用於消費電子領域的存儲芯片	2023年	45天
總計	**122,239.9**	**43.6%**			

客戶	收入	佔總收入百分比	向我們採購的主要產品／服務	業務關係開始年份	信用期
	(人民幣千元)				
截至2025年12月31日止年度					
1. 客戶A[1].....	453,946.8	37.2%	存儲模組配套芯片	2018年	30天
2. 客戶F[6].....	81,079.8	6.6%	存儲模組配套芯片、用於汽車電子及工業控制的高可靠性存儲芯片、用於消費電子領域的存儲芯片／攝像頭馬達驅動芯片／NFC芯片	2020年	60天
3. 客戶B[2].....	54,279.6	4.4%	存儲模組配套芯片、用於汽車電子及工業控制的高可靠性存儲芯片、用於消費電子領域的存儲芯片／攝像頭馬達驅動芯片／NFC芯片	2023年	45天
4. 客戶G[7].....	53,376.7	4.4%	存儲模組配套芯片、用於汽車電子及工業控制的高可靠性存儲芯片	2022年	60天
5. 客戶E[5].....	35,734.8	2.9%	存儲模組配套芯片、用於汽車電子及工業控制的高可靠性存儲芯片、用於消費電子領域的存儲芯片	2023年	45天
總計	**678,417.7**	**55.5%**			

客戶	收入	佔總收入百分比	向我們採購的主要產品／服務	業務關係開始年份	信用期
	(人民幣千元)				
截至2024年12月31日止年度					
1. 客戶A[1].....	353,697.7	34.4%	存儲模組配套芯片	2018年	30天
2. 客戶F[6].....	121,544.1	11.8%	用於汽車電子及工業控制的高可靠性存儲芯片、用於消費電子領域的存儲芯片／攝像頭馬達驅動芯片／NFC芯片	2020年	60天
3. 客戶B[2].....	54,701.5	5.3%	存儲模組配套芯片、用於汽車電子及工業控制的高可靠性存儲芯片、用於消費電子領域的存儲芯片／攝像頭馬達驅動芯片	2023年	45天
4. 客戶H[8].....	32,515.2	3.2%	用於消費電子領域的存儲芯片／NFC芯片	2018年	60天
5. 客戶I[9]	28,761.6	2.8%	用於汽車電子的高可靠性存儲芯片、用於消費電子領域的存儲芯片／攝像頭馬達驅動芯片	2021年	60天
總計	**591,220.1**	**57.5%**			
截至2023年12月31日止年度					
1. 客戶A[1].....	161,356.0	22.9%	存儲模組配套芯片	2018年	30天
2. 客戶F[6].....	132,792.8	18.9%	汽車電子及工業控制的高可靠性存儲芯片、用於消費電子領域的存儲芯片／攝像頭馬達驅動芯片	2020年	60天
3. 客戶B[2].....	47,448.5	6.7%	用於汽車電子的高可靠性存儲芯片、用於消費電子領域的存儲芯片／攝像頭馬達驅動芯片／NFC芯片	2023年	45天
4. 客戶I[9]	34,380.0	4.9%	用於汽車電子的高可靠性存儲芯片、用於消費電子領域的存儲芯片／攝像頭馬達驅動芯片	2021年	60天
5. 客戶H[8].....	30,318.9	4.3%	NFC芯片	2018年	60天
總計	**406,296.2**	**57.7%**			

附註：

(1) 客戶A是一家位於澳門的國際領先的數據處理及互聯集成電路設計公司。客戶A為直銷客戶。

(2) 客戶B是一家中國公司，主要從事電子解決方案的設計及相關電子產品及計算機軟件的銷售。客戶B為分銷商。

(3) 客戶C是一家中國公司，專注於電子元器件及集成電路銷售以及相關的技術服務。客戶C為分銷商。

(4) 客戶D是一家香港公司，專注於電子元器件的分銷及提供綜合解決方案。客戶D為分銷商。

(5) 客戶E是一家中國公司，主要從事通訊及電子產品與相關商品之銷售。客戶E為分銷商。

(6) 客戶F是一家中國公司，獲國際知名半導體芯片公司授權在大中華區銷售存儲類芯片產品。客戶F為分銷商。

(7) 客戶G是一家中國領先的公司，主要從事汽車、電子及新能源業務，並已於香港聯交所及深圳證券交易所上市。客戶G為直銷客戶。

(8) 客戶H是一家中國公司，從事電腦軟硬件銷售及IC芯片設計開發。客戶H為分銷商。

(9) 客戶I是一家中國公司，主要從事電腦、通訊及其他電子設備之製造。客戶I為分銷商。

於往績記錄期間各年度／期間，我們的前五大客戶分別佔我們2023年、2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月總收入的57.7%、57.5%、55.5%及43.6%。於往績記錄期間，我們為廣泛的客戶群提供服務，其中許多是內存模組、汽車電子、工業控制及消費電子領域的全球領先企業。同時，我們也通過分銷商銷售我們的產品。於往績記錄期間，我們與主要客戶保持穩定的業務關係。

我們已與客戶A（我們於往績記錄期間各年度／期間的單一最大客戶）訂立獨家合作安排。根據此安排，雙方共同開發新一代內存模組，且客戶A負責向終端客戶銷售有關共同開發的產品。因此，於2023年、2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月，我們來自往績記錄期間各年度／期間單一最大客戶的收入分別為人民幣161.4百萬元、人民幣353.7百萬元、人民幣453.9百萬元及人民幣74.8百萬元，分別佔我們於各年度／期間收入的22.9%、34.4%、37.2%及26.7%。有關收入最終源自客戶A所服務的廣泛終端客戶群，包括下游市場的頂級參與者及各種其他參與者。鑒於我們的合作互為獨家性質、我們共同開發產品的領先定位以及終端客戶群的多樣性，我們認為我們與客戶A的合作屬可持續，且相關的客戶集中風險有限。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們與上述客戶概無任何重大糾紛，亦未收到該等客戶的任何重大投訴。於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們並無收到客戶的任何重大退貨，且據我們董事及高級管理層所知，截至最後實際可行日期，概無潛在的重大退貨。

於往績記錄期間各年度／期間，我們所有前五大客戶均直接與我們結算貨款。據本公司所深知，我們於往績記錄期間各年度／期間的所有前五大客戶均為獨立第三方。我們的中國法律顧問表示，於往績記錄期間各年度／期間，概無董事、彼等各自

的聯繫人或截至最後實際可行日期擁有我們已發行股本5%以上的任何股東於我們任何五大客戶中擁有任何權益。

我們的供應商

我們採用無晶圓廠業務模式。我們的供應商主要是第三方晶圓代工廠以及封裝及測試服務提供商。向供應商支付的成本主要包括採購原材料(如晶圓)的成本，以及獲取封裝及測試服務的成本。

我們的供應商主要包括第三方晶圓代工廠及半導體封裝測試外包(OSAT)公司。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們委聘4家晶圓代工廠及33家OSAT公司。於往績記錄期間各年度／期間，我們向前五大供應商的採購額分別佔我們於2023年、2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月總採購額的90.1%、91.3%、85.0%及81.9%。我們的原材料主要為晶圓和封裝及測試材料。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無遇到任何導致生產中斷的原材料供應短缺或延誤。我們相信，我們與供應商的穩定關係將繼續確保原材料的充足穩定供應，並有助於控制未來的價格波動。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們的原材料並無出現對我們的營運產生重大影響的質量問題。

為減輕供應商集中風險，我們已與替代晶圓代工廠建立關係作為後備供應商，並一直探索在韓國及新加坡與海外代工廠建立合作關係作為應變安排。我們與主要代工廠合作夥伴維持長期穩定關係(可追溯至2009年)，通常受初始期限為三至五年並按年續期的框架協議所規管，且於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無經歷任何供應中斷或該等關係出現重大不利變動。我們認為我們與主要代工廠合作夥伴的關係發生重大不利變動或終止的可能性較低。根據弗若斯特沙利文的資料，無晶圓廠集成電路設計公司依賴少數代工廠合作夥伴以進行更深入的技術合作、獲得定價優勢及確保供應穩定性，乃屬常見的行業慣例，且市場上有足夠數量的替代供應商能提供具有相若質量、產能及商業條款的產品。

下表載列往績記錄期間各年度／期間我們五大供應商的背景資料。

供應商	採購額	佔總採購額百分比	為我們提供的主要產品／服務	業務關係開始年份	信用期
	(人民幣千元)				
截至2026年3月31日止三個月					
1. 供應商A[(1)]...	54,885.1	34.8%	晶圓代工廠	2009年	30天
2. 供應商B[(2)]...	26,894.3	17.0%	晶圓	2025年	30天
3. 供應商C[(3)]...	22,812.5	14.4%	晶圓代工廠	2021年	0天
4. 供應商D[(4)]...	14,899.2	9.4%	封裝及測試合同製造	2009年	45天
5. 供應商E[(5)]...	9,916.7	6.3%	封裝及測試合同製造	2009年	60天
總計	**129,407.8**	**81.9%**			

供應商	採購額	佔總採購額百分比	為我們提供的主要產品／服務	業務關係開始年份	信用期
	(人民幣千元)				
截至2025年12月31日止年度					
1. 供應商A(1)...	254,376.7	43.8%	晶圓代工廠	2009年	30天
2. 供應商C(3)...	84,410.9	14.5%	晶圓代工廠	2021年	0天
3. 供應商D(4)...	60,857.3	10.5%	封裝及測試合同製造	2009年	45天
4. 供應商E(5)...	53,386.6	9.2%	封裝及測試合同製造	2009年	60天
5. 供應商F(6)...	40,784.7	7.0%	封裝及測試合同製造	2015年	60天
總計	**493,816.2**	**85.0%**			
截至2024年12月31日止年度					
1. 供應商A(1)...	270,654.2	46.4%	晶圓代工廠	2009年	30天
2. 供應商C(3)...	144,830.5	24.8%	晶圓代工廠	2021年	0天
3. 供應商E(5)...	60,177.4	10.3%	封裝及測試合同製造	2009年	60天
4. 供應商D(4)...	30,208.2	5.2%	封裝及測試合同製造	2009年	45天
5. 供應商F(6)...	26,883.6	4.6%	封裝及測試合同製造	2015年	60天
總計	**532,753.9**	**91.3%**			
截至2023年12月31日止年度					
1. 供應商A(1)...	211,414.2	53.9%	晶圓代工廠	2009年	30天
2. 供應商E(5)...	54,284.4	13.9%	封裝及測試合同製造	2009年	60天
3. 供應商C(3)...	40,888.4	10.4%	晶圓代工廠	2021年	0天
4. 供應商G(7)...	23,447.6	6.0%	封裝及測試合同製造	2011年	30天
5. 供應商D(4)...	22,961.8	5.9%	封裝及測試合同製造	2009年	45天
總計	**352,996.4**	**90.1%**			

附註：

(1) 供應商A是一家中國公司，從事IC相關電子產品研發與生產。供應商A於香港聯交所及上海證券交易所雙重上市。

(2) 供應商B是一家台灣的存儲IC設計公司。其於台灣證券交易所上市。

(3) 供應商C是一家於香港聯交所及上海證券交易所雙重上市公司之全資附屬公司，其主要從事IC相關電子產品的研發與生產。

(4) 供應商D是一家中國公司，從事高密度印刷電路板、光電元件及其他IC部件之生產，同時涉及半導體IC部件之封裝測試及封裝類別之設計開發。

(5) 供應商E立足於中國，主要從事半導體芯片及相關封裝測試產品之研發與生產。

(6) 供應商F是一家於深圳證券交易所上市的中國公司，主要從事IC與MEMS傳感器封裝測試業務。

(7) 供應商G是一家中國封裝及測試服務提供商，其率先採用IC前端芯片製造系統與標準服務全球客戶。

截至最後實際可行日期，概無董事、彼等各自的聯繫人或緊隨[**編纂**]完成後擁有本公司已發行股本5%以上的任何股東於往績記錄期間各年度／期間於我們五大供應商中擁有任何權益。據我們董事所知，往績記錄期間各年度／期間，我們的五大供應商均為獨立第三方。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無因從供應商採購的產品供應出現任何重大短缺或延誤而經歷任何業務中斷。於往績記錄期間各年度／期間，我們的五大客戶概非我們的供應商，且我們於往績記錄期間各年度／期間的五大供應商亦非我們於往績記錄期間各年度／期間的客戶。

我們與晶圓代工廠合作夥伴訂立的協議的主要條款

我們一般與主要晶圓代工廠合作夥伴訂立框架協議，實際價格及數量在單獨的採購訂單中列明。於往績記錄期間，我們並無與供應商訂立任何獨家供應協議。該等協議的條款因具體產品或項目而異，並可能受多種因素(包括但不限於晶圓代工廠合作夥伴的可用產能)影響。但該等協議一般包含以下條款：

主要條款	描述
年期	初始年期為三至五年，視乎按年續期情況而定
各方的主要權利及義務	我們向晶圓代工廠合作夥伴提供產品參數、技術規格、生產工藝要求及其他產品要求。我們的晶圓代工廠合作夥伴根據我們的要求製造晶圓產品。 我們向封裝及測試服務提供商提供晶圓產品及技術規格，由彼等根據我們的要求提供封裝及測試服務。
產量	我們通常按採購訂單決定任何特定期間的產量。晶圓代工廠將按特定採購訂單所載的特定數量及特定價格於該期間向我們供應產品。我們亦與供應商制定月度滾動計劃。當產能需求增加時，供應商將相應調整產能、原材料、設備及人員配置。
付款及信貸期	信貸期及付款方式應在採購訂單中列明。我們獲主要供應商授予若干信貸期，為30天至60天。
最低採購要求	無。

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

主要條款	描述
物流	我們聘請第三方物流服務提供商，按我們與供應商約定的地點及時間，在我們的製造商、測試及封裝服務提供商之間運送物料。
退貨	我們有權退回未能達到約定質量標準的缺陷物料，且供應商須提供補救措施，包括退貨及／或換貨。
保密	我們通常在框架協議中設定保密條款，保密義務的期限可能會延長至協議屆滿後。
終止	框架採購協議通常於約定期限屆滿時終止，若發生下列情況，亦可提前終止：(i)經雙方同意，(ii)發生不可抗力事件，及(iii)發生重大違約時由非違約方終止。

我們產品的銷售網絡

分銷

根據市場慣例，我們借助分銷商支持我們的產品銷售。向分銷商銷售產品及解決方案的收入分別佔我們2023年、2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月收入的約68.7%、54.0%、51.4%及60.2%。我們所有的分銷商均為企業實體。彼等協助我們提供客戶支持，包括日常溝通、基本技術支持及客戶關係管理。雖然三條產品線的整體分銷商安排一致，但各自項下的具體銷售安排略有不同，以便更好地配合市場動態及客戶需求。業內對分銷商並無特定資格要求。我們主要基於分銷商的客戶資源及往績記錄選擇分銷商。作為我們盡職調查的一部分，我們會審閱彼等的商業登記文件、選定財務資料及分銷計劃。倘分銷商委任任何次級分銷商，彼等須通知我們。我們與該等次級分銷商並無任何合約或營運關係。根據向我們呈報的資料，該等次級分銷商均為企業實體，且大部分為系統集成商。

下表載列於各所示年度／期間為我們創造收入的分銷商總數及其於往績記錄期間的變動情況。

	截至12月31日止年度			截至3月31日止三個月
	2023年	2024年	2025年	2026年
期初分銷商數目	80	93	108	114
新增分銷商數目	15	23	17	4
已終止分銷商數目(1)	2	8	11	8
期末分銷商數目	93	108	114	110

附註：

(1) 指上一年度為我們產生收入但於本年度／期間未為我們產生收入的分銷商數目。

於2023年、2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月，41家、44家、46家及46家海外分銷商分別為我們創造了收入，覆蓋範圍橫跨亞洲、北美及歐洲。我們的海外分銷商為當地市場領先的半導體分銷商，擁有成熟的客戶網絡及技術支持能力。

已終止分銷商有所增加，主要是由於不活躍賬戶年／期內並未下達訂單所致。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們與已終止分銷商並無任何重大糾紛。

我們向分銷商提供建議售價，但並不限制彼等釐定最終售價的自主權。通常並無最低採購金額要求。我們訂立的部分分銷協議包含價格調整機制安排，該機制基於多種因素釐定，例如(i)分銷商訂購的產品數量；及(ii)本公司與分銷商於先前建立的業務關係。我們的價格調整機制旨在為分銷商提供靈活性，而不限制彼等釐定最終售價的酌情權。一般而言，隨著訂單量增加，每單位的平均售價可能會下調，以反映批量效應及維持我們於市場的競爭地位。於市場需求增加期間，我們或會透過分銷商渠道提供更具競爭力的單位定價，以促進市場滲透，同時由於我們保留跨多個銷售渠道及客戶分部優化定價的能力，我們的整體定價靈活性保持不變。雖然透過分銷商渠道降低的平均售價可能會對我們的定價造成下行壓力，但銷量相應增加預期將在生產及分銷方面產生規模經濟，可能部分抵銷對毛利率的任何不利影響。我們尋求在單位定價考慮因素與銷量增長目標之間取得平衡，以在總體基準上維持穩定的毛利率表現。

避免渠道塞貨的措施

我們已制定並實施多項措施，避免渠道塞貨，以此保障分銷商的利益，包括：

- *買賣關係*。我們與分銷商屬買賣關係。除非是由於質量問題，我們通常不接受退貨，確保分銷商不會強迫我們接受未售出的產品。我們定期監控分銷商的退貨水平。於往績記錄期間，退貨金額佔我們向分銷商銷售總額不足1%。

- *無最低採購目標*。我們通常不為分銷商設定最低採購目標，以避免分銷商積壓過多產品。

- *月度報告*。我們透過報告機制監控及管理分銷商，根據該機制，分銷商須提供月度銷售報告，包括銷量及產品類別。

- *實際需求*。我們的分銷商通常於收到預測或採購訂單後向我們下單，這本身就會降低其存貨風險並加速其存貨週轉速度。此外，我們與分銷商保持定期溝通，並鼓勵分銷商根據市場需要下達訂單及調整其採購頻率。

避免蠶食效應的措施

我們已實施反蠶食措施。我們的國際分銷商僅限於在指定區域進行分銷。針對大中華地區的分銷，我們依據附屬公司所在地，將銷售範圍劃分為華北和華南，以此管理分銷商。我們對分銷商採用登記制度，據此，分銷商須向我們登記最終客戶；一旦最終客戶獲某一分銷商登記，其他分銷商不得向該客戶分銷相同產品。我們的分銷商

安排載列一般商業條款，包括定價指引及分銷範圍。我們不時與分銷商保持溝通，以了解彼等的銷售活動。我們定期審查分銷商的銷售報告，以監控其銷售我們產品的價格。透過該等措施，我們能夠協調及監控分銷商的銷售情況。我們相信該等措施能有效降低蠶食風險，並維持我們分銷渠道的效率。

我們產品分銷協議的主要條款

下文載列我們與分銷商訂立的協議的主要條款概要：

- *年期*。我們一般訂立為期一年的主分銷協議，除非任何一方提前終止（通常須提前30天通知），否則每年自動續期。

- *定價*。我們通常按出貨時有效的固定價格向分銷商銷售我們所有三大業務線的產品。我們與分銷商設定的固定價格乃基於多種因素釐定，例如(i)產品應用的垂直行業；(ii)分銷商訂購產品的數量；(iii)本公司與分銷商於先前建立的業務關係；及(iv)分銷商的預計支出預算。我們訂立的部分分銷協議包括價格調整機制的安排。

- *最低採購金額*。通常並無最低採購金額要求。

- *分銷範圍*。分銷協議屬非獨家性質，國際分銷商通常受限於在指定區域進行分銷。

- *二級分銷*。我們的分銷商一般不被限制聘請二級分銷商。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，據我們所知，部分分銷商在銷售我們的產品及解決方案時聘請二級分銷商。

- *退換貨限制*。我們一般不接受分銷商退貨或換貨，除非我們的產品存在任何質量問題。

- *付款及信貸期*。分銷商購買產品的款項一般須於開具發票月末起計60天內支付。

- *遵守相關法律*。我們的分銷商在分銷我們的產品時，必須遵守所有適用法律。

- *終止*。通常，任何一方均可在事先通知的情況下終止任何續期。任何一方均可於提前30天內通過書面通知後終止協議。倘分銷商發生任何重大違約或無力償債，我們亦可立即終止該等協議。

分銷模式及會計處理

我們在分銷商根據合同條款簽收產品時確認收入。在確認收入前，該等產品仍被歸類為我們存貨的一部分。

一旦產品所有權轉移至分銷商，即不再允許退貨(除非質量問題)，任何解決請求均須透過分銷協議中概述的更換程序處理。我們可以協助在分銷協議終止時，將存貨轉移給第三方。於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們並無回購任何先前售予分銷商的產品。

我們對分銷商的管理

為保持高運營及品牌標準，我們全年度持續評估分銷商。我們已實施詳盡的甄選程序，以確保潛在分銷商具備足夠能力為終端客戶提供服務並有效營銷我們的產品。我們評估的關鍵標準包括其現有客戶群、核心產品供應、已建立的客戶關係及倉儲能力。

我們與分銷商緊密合作，提供持續的運營支持，旨在推動其成功並促進可持續增長。這包括提供培訓課程以提升其團隊的產品知識，並幫助其更有效地管理存貨水平。

我們簽訂分銷協議，事先列明定價、基於數量的折扣及地理覆蓋範圍。我們透過分銷商的定期報告監察該等條款的遵守情況。我們不向分銷商提供回扣。

我們按固定頻率對分銷商進行審查，並採取分銷商管理措施(如定期評估)，以持續提升分銷商的質量管理水平。我們基於多種因素審查分銷商，包括(i)一般背景，如其資質、經營範圍、業務規模、相關行業經驗、當地分銷網絡、銷售點的地域覆蓋、客戶服務能力以及銷售及技術支持能力；(ii)產品協同效應，我們會評估分銷商的其他授權產品是否與我們的產品衝突，或我們的產品與其其他授權產品之間是否存在任何協同效應；(iii)向客戶提供包含不同產品的解決方案的能力；及(iv)系統化管理，我們會評估分銷商是否擁有完善的數據基礎設施，包括強大的客戶關係管理系統及銷售數據分析能力。

直銷

我們的直銷模式是主要服務於AI服務器、汽車電子、工業控制和消費電子行業的頭部戰略客戶。我們的銷售及營銷團隊精通與我們產品相關的專業知識，使其能夠有效傳達我們的技術價值及產品性能。我們相信，我們的直銷有助於我們鞏固及提高市場份額，並有效滲透不同的垂直行業。

我們的直銷通常根據買賣安排進行。我們與直銷客戶存在買賣關係，並在彼等根據合同條款簽收交付的產品時確認收入。

與直銷客戶訂立的協議的主要條款

與我們直銷客戶訂立的協議條款因具體產品或項目以及我們與每名客戶的談判結果而異，但該等協議一般包含以下條款：

年期 ..... 一般為一至三年，附帶自動續期條款，除非提前終止或另有約定。

定價 ..... 我們產品的售價將在客戶下達的訂單中單獨約定。價格乃透過個別磋商釐定，以反映開發的複雜性、數量承諾及雙方關係的戰略性質。

風險轉移..... 風險於客戶根據合同條款簽收產品時轉移至客戶。

付款及信貸期..... 我們通常向直銷客戶提供30天至120天不等的信貸期，惟仍取決於其經營狀況、財務狀況及預期交易量。

最低採購要求..... 我們與客戶的框架協議通常不包含最低採購要求。

產品交付..... 我們一般負責按客戶訂單指定的地點及時間交付產品。

退貨／換貨 ..... 我們的客戶將在交付時檢查產品，且一般有權退回或更換在質量或規格方面不符合其要求的產品。

保密 ..... 該等框架協議通常載有嚴格的保密條文，限制我們披露主要客戶的機密資料。

終止 ..... 該等框架協議可經雙方同意終止，或在若干情況下（如未糾正重大違約、發生不可抗力或一方破產）單方面終止。

轉讓定價安排

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本公司及我們的附屬公司於本集團的業務過程中進行若干集團內交易以促進我們附屬公司各自的職能。我們的集團內交易主要包括各項服務及產品銷售。我們遵循公司內交易必須按公平基準進行的基本原則。

於往績記錄期間，我們的集團內交易主要包括以下各項：

- 提供銷售支持服務。我們的一家附屬公司向另一家附屬公司提供銷售支持服務。服務提供方亦承擔若干客戶服務責任，而服務接受方具有產品銷售職能。

- 提供研發服務。我們的若干附屬公司就特定研發項目向其他實體提供研發服務。

- 產品銷售。我們的若干附屬公司作為我們的銷售實體運作。該等公司自本公司採購製成品，然後將製成品直接出售予第三方。

我們已聘請轉讓定價顧問對集團內交易進行審查。我們的轉讓定價顧問對集團內交易進行了年度審查，並進行了基準分析研究。我們的轉讓定價顧問認為：(i)我們的集團內交易定價符合相關法規和指引規定的公平交易原則；(ii)我們在轉讓定價方面的稅務風險有限；(iii)我們的集團內交易與各相關附屬公司履行的職能、承擔的風險和獲得的收益相符。根據上述分析及轉讓定價顧問的意見，董事認為，且獨家保薦人同意，本集團於往績記錄期間並無違反相關轉讓定價法規及指引，亦無接獲有關當局就該等交易作出的任何審核、調查或質疑。

為確保我們持續遵守適用的轉讓定價法律及法規，我們已實施以下措施：

- 我們的財務團隊定期與轉讓定價顧問溝通，以保持對監管要求及主要稅務實務的了解；

- 我們持續審查及監控我們的轉讓定價安排，並繼續委聘第三方稅務顧問對該等安排進行審閱，確保其符合公平交易原則；及

- 如果轉讓定價文件需要向稅務機關報送，該等文件將由專人編製，並在內部審閱及批准後提交。

品牌推廣及營銷

品牌推廣

我們致力於通過提供卓越的產品質量、可靠的性能、專業的技術支持服務以及協同的研發能力，並輔以精準的營銷舉措，來提升品牌知名度。我們認為，在我們所處的行業中，最有效的營銷方式源於依託這些核心優勢建立良好的市場聲譽。具體而言，我們的銷售及營銷策略旨在建立品牌認知度、增加客戶對我們產品與解決方案的需求、培養與客戶的長期戰略合作夥伴關係、推動交叉銷售機會，並挖掘潛在的增量業務。

依託既有的品牌價值與以客戶為中心的運營優勢，我們已在半導體供應鏈中建立了龐大的忠實客戶群。同時，我們亦開展多種精準的項目及活動，例如參與知名的行業會議與展覽會，以此展示我們的技術優勢，並向更廣泛的潛在合作夥伴推廣我們的產品與解決方案。

銷售及營銷／客戶技術支持

我們的銷售及營銷策略亦側重於與行業頭部的模組廠商和終端品牌廠商建立業務及技術關係，以便就符合其產品路線圖的未來半導體解決方案與彼等緊密合作。以大眾市場應用為目標的主要行業領導者通常進行嚴格的評估程序，以為其即將推出的產

品選擇最合適的半導體解決方案。供應商通過評估程序獲得成功的設計通常被稱為「定點」。我們與客戶緊密合作，設計出綜合解決方案，以提升彼等產品的性能及效率。我們的工程師與客戶的工程師合作，創造符合其規格並以具競爭力的價格提供高性能的產品。

我們亦直接向服務器、汽車、PC及智能手機製造商營銷我們的產品，以便我們的產品能夠獲得其規格認證並設計納入其產品中。尤其在汽車領域，我們的車規級芯片已獲得多家全球一級供應商的認證，可部署於領先的汽車製造商平台及其他終端系統。例如，我們的車規級EEPROM已成功獲得資格並納入一家位於中國的全球領先汽車品牌的供應商組合。經過嚴格的認證程序(包括可靠性測試、設計驗證及優化產品以滿足汽車製造商嚴格的規格要求)後，我們的產品獲批准部署在關鍵應用中，包括車載攝像頭模組及電池管理系統。我們根據主採購協議進行供應。我們的汽車合作夥伴可能會提供提前需求預測，以協助我們進行生產規劃。我們可能會按月協商價格。具體數量和交貨時間表在採購訂單中確認，我們負責運輸和交付。除此策略外，我們的產品還透過領先的模組製造商整合到汽車子系統中，並在汽車行業中廣泛應用。

我們的銷售及營銷團隊擁有高水平的技術專長及行業知識，使其能夠有效支持漫長且複雜的銷售過程。截至2026年3月31日，我們擁有一支由68名全職僱員組成的專責銷售及營銷團隊。該團隊包括一群受過嚴格培訓的產品經理及現場應用工程師，彼等具備充足能力應對客戶需求並提供解決方案。此外，我們的團隊擁有戰略營銷經驗及識別並利用新興市場趨勢的強大能力，確保我們在快速變化的行業環境中保持領先地位。我們亦向潛在及現有客戶提供技術支持及協助，以促進我們的解決方案順利整合至其產品中。我們相信，這種設計支持的深度及質量是縮短客戶產品上市時間及維持高水平客戶滿意度的關鍵。

我們參加定期召開的技術論壇，促進其產品開發團隊與我們研發團隊之間的直接互動。我們透過此方式，亦透過戰略夥伴推薦及直接外展的方式獲取客戶。就海外客戶而言，我們透過定期虛擬通訊、專屬客戶管理及定期現場拜訪以提供技術支持及設計協同以維持關係。此外，我們的客戶正越來越多地利用合約製造商，同時保留設計及關鍵組件認證活動。隨著這一趨勢的成熟，我們不斷升級銷售運營及製造支持，以最大限度地提高我們的效率、靈活性以及與客戶的協調。

環境、社會及管治

我們認識到環境、社會及管治(ESG)事宜對本公司可持續發展的重要性，並不斷加強ESG在營運各方面的整合。我們將繼續致力於提高我們產品和服務的全球競爭力，並通過對社會和環境的積極貢獻來支持公司的長期可持續發展。[**編纂**]後，我們將遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄C2所載的《環境、社會及管治報告守則》，每年刊發ESG報告，向利益相關者披露本公司的ESG管理情況。

公司治理

ESG治理

我們充分認識到環境及社會責任對我們業務的重要性。為加強我們的ESG管理，我們已建立由董事會、戰略與可持續發展委員會（將於[**編纂**]後成立）以及ESG工作小組組成的三級ESG治理框架。在此框架下，董事會作為最高監管機構，對ESG事務承擔最終責任。董事會下設戰略與可持續發展委員會，負責研究及管理本公司的發展戰略，包括就ESG戰略、原則及政策提供建議、組織關於可持續發展目標的可行性研究、定期審閱ESG進度（於需要時尋求外部專業支持）、評估ESG相關風險，並於必要時根據適用法規調整可持續發展戰略。戰略與可持續發展委員會亦審閱ESG報告以及其他相關ESG披露，並向董事會提出建議以供批准。ESG工作小組負責落實ESG管理計劃及措施，並持續識別、評估及報告ESG相關風險及改進建議，以確保ESG管理體系的有效實施。

下表載列董事會在ESG方面的專長。

姓名	性別	職務	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	戰略委員會	財務專家	風險專家	行業專家
陳作濤	男	董事長		√	√	√			√
張建臣	男	董事兼總經理				√	√		√
翁華強	男	董事兼董事會秘書					√	√	
羅知	女	獨立非執行董事	√	√	√		√	√	
陳冬	女	獨立非執行董事	√		√		√	√	
毛振華	男	獨立非執行董事				√	√	√	
孫凱	男	獨立非執行董事	√	√				√	

在此框架下，董事會作為最高監督機構，對ESG事宜負最終責任。為確保我們的戰略與ESG原則有效結合，我們將董事會成員的專業背景及能力納入考慮範圍，並按財務專家、風險專家及行業專家進行分類。

商業道德

我們對任何形式的腐敗行為採取零容忍政策，並嚴格遵守適用的反腐敗法律法規，包括但不限於《中華人民共和國反不正當競爭法》及《中華人民共和國刑法》。我們亦在僱員及合作夥伴中維持嚴格的行為準則及反腐敗政策，嚴禁在業務營運中進行賄賂或其他不當支付。此項禁令適用於全球所有業務活動，無論涉及政府官員還是第三方專業人士。本政策禁止的不當支付包括賄賂、回扣、過度饋贈或款待，或為獲取不

正當商業優勢而作出或提供的任何其他付款。我們保存準確的賬簿及記錄，以合理細節反映交易及資產處置情況。凡涉及索取虛假發票，或請求支付異常、過度或缺乏充分說明的款項，均應予以拒絕並及時報告。我們的賬簿及記錄中絕不接受誤導性、不完整或虛假的條目。我們亦將確保營銷團隊人員遵守適用的推廣及廣告要求。

我們已實施廣泛的反腐敗及反賄賂內部控制措施，包括：

- 為董事、高級管理層及僱員提供定期反腐敗及反賄賂合規培訓；
- 監控有關供應商管理、招標及投標過程以及財務支付管理的賬簿、記錄及賬目，以識別任何虛假、誤導性或未披露的條目；及
- 建立舉報機制，並鼓勵僱員、供應商、客戶及其他第三方報告可疑活動及違反政策的行為。

此外，我們已建立標準化的舉報受理機制，以確保所有舉報均得到及時、公平的處理。我們為內部僱員及外部利益相關者提供多種舉報渠道，並嚴格保護舉報人的合法權益。我們已建立專門的調查程序，以確保每項舉報均經過獨立客觀的調查及核實。經核實的違規行為將根據本公司政策及適用法律法規予以嚴肅處理。我們將就舉報信息及舉報人身份採取嚴格的保密措施，並嚴禁任何形式的報復。

ESG風險管理

我們已建立透明且高效的渠道與利益相關者進行交流，並透過一系列線上及線下方式，與股東、政府、監管機構、客戶、僱員、供應商及其他利益相關者保持緊密溝通。我們積極徵求並採納利益相關者對ESG管理的意見，並持續完善我們的ESG實踐，以符合利益相關者的預期。根據我們的業務特點及利益相關者的優先事項，我們已識別以下重大ESG議題，評估其潛在風險及戰略機遇，並採取有效措施予以應對。我們識別出的ESG風險與機遇包括氣候變化應對、水資源管理、廢物管理、僱員、產品責任、知識產權保護、供應鏈管理及社區貢獻。

我們將該等ESG風險及機遇充分融入我們的整體企業戰略和日常運營管理中，包括：

- 融入最高層面的企業管治架構及戰略規劃；
- 融入我們的風險管理框架；及
- 與利益相關方保持動態更新。

我們已根據過往營運表現和可合理預見的未來情況，評估了已識別的重大ESG風險和機會。基於此評估，我們未發現任何對我們的營運具有重大財務影響的ESG合規風險。

環境

氣候變化應對

我們已識別若干可能對我們的業務營運造成不利影響的氣候相關風險，評估其潛在影響，並制定相應的應對計劃。我們亦密切監察氣象部門發佈的颱風路徑、強度等級及暴雨警告信號，並根據警告級別啟動針對性應急措施，以確保人員安全及業務連續性。

我們識別與環境問題相關的潛在財務及聲譽風險，包括因遵守現行環境法規及更嚴格標準而產生的風險。例如，中國於2020年宣佈的碳中和目標（旨在於2030年前實現二氧化碳排放峰值，並於2060年前實現碳中和）可能會增加能源採購成本，原因是我們可能需要承擔採購綠色能源（可能比傳統能源更昂貴）或購買或升級設備的轉型成本。

我們在產品質量、滿足下遊客戶期望的能力、經驗及聲譽方面面臨競爭。技術的快速變革及行業標準的不斷演變加劇了此項競爭。我們亦意識到氣候相關事宜對本公司的業務構成額外風險。

類別		潛在影響
物理風險.....	急性風險（例如：颱風、水災）及慢性風險（例如：海平面上升、氣候模式持續轉變）	急性及慢性風險可能中斷本公司辦公及研發活動的連續性，從而對研發進度、項目交付節奏及客戶溝通效率產生不確定性。該等風險亦可能透過上游晶圓代工、封裝、測試及物流環節傳導，增加供應鏈協調及產品交付管理的複雜性，並可能影響本公司的履約能力及客戶滿意度。
過渡風險.....	政策風險（源於碳排放監管持續收緊）及聲譽風險（受利益相關者對綠色發展的期望日益提高所驅動）	隨著全球及區域層面的氣候及可持續發展監管力度加強，以及客戶及[**編纂**]對ESG披露的關注度日益提高，本公司在信息披露、合規管理及供應鏈責任管理方面可能面臨轉型風險，從而可能增加管理成本。此外，由於客戶及[**編纂**]愈發重視供應鏈的可持續性，對芯片產品全生命週期環保表現及供應鏈實踐的關注度提高，或會促使本公司投入更多資源於供應商篩選、合作夥伴管理及可持續採購，以滿足市場及監管預期並保持競爭力。

類別		潛在影響
機遇	綠色產品機遇（受市場對低碳、環保產品及解決方案日益增長的需求所驅動）	隨著市場對低碳、節能及環保技術解決方案的需求日益增長，本公司在高能效、低功耗芯片及相關解決方案領域面臨業務擴張的新機遇。透過持續提升芯片設計能力及產品性能，本公司可推進產品在能源管理、智能設備、綠色基礎設施及相關場景中的應用。此舉將有助於增強產品競爭力、擴大客戶群，並支持下游應用提升能源效率及降低碳排放強度，從而為本公司創造新的收入增長機遇。

我們於營運中一貫秉持節能環保原則，嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》及其他適用環境法律法規，並已制定專門針對環境保護的內部政策。本公司已建立健全能源安全與節約閉環管理體系。我們定期宣傳安全用電，開展夜間巡檢，並使用智能空調檢測系統，提升節能效率。

下表載列我們上海總部辦公區於往績記錄期間的溫室氣體及能源績效：

類別	單位	截至2023年12月31日止年度	截至2024年12月31日止年度	截至2025年12月31日止年度	截至2026年3月31日止三個月
溫室氣體排放					
範圍1[1]	tCO_2e	–	–	–	–
範圍2[2]	tCO_2e	754.53	694.97	689.62	179.18
範圍3－類別5：營運活動中產生的廢棄物[3]	tCO_2e	1.03	1.24	1.24	0.32
溫室氣體排放總量	tCO_2e	755.56	696.22	690.86	179.50
溫室氣體排放強度	tCO_2e／人民幣百萬元收入	1.07	0.68	0.57	0.64
能源消耗					
綜合能源消耗[4]	MWh	1,252.32	1,203.00	1,299.70	337.70
綜合能源消耗強度	MWh／人民幣百萬元收入	1.78	1.17	1.06	1.21

附註：

(1) 我們的日常營運並不涉及範圍1溫室氣體排放源。

(2) 我們的範圍2溫室氣體排放源自外購電力，並分別根據中華人民共和國生態環境部公佈的2023年及2024年全國電網平均二氧化碳排放係數（分別為0.6205 kg CO_2/kWh及0.5777 kg CO_2/kWh）計算得出。

(3) 我們的範圍3溫室氣體排放主要源自生活污水，其排放係數參考自生態環境部環境標準研究所發佈的《中國產品全生命週期溫室氣體排放係數集》。

(4) 我們在營運過程中所消耗的能源類型僅為外購電力，並根據《綜合能耗計算通則》(GB/T 2589-2020)進行計算。

考慮到本公司的業務發展週期以及內外部環境因素，我們已初步設定溫室氣體排放及能源消耗的中期目標。到2030年，我們計劃：

- 與2024年相比，將每單位收入的溫室氣體排放量減少10%；及
- 與2024年相比，將單位收入能耗減少10%。

我們為減少溫室氣體排放而採取的措施包括定期開展安全用電意識活動、每晚進行巡查以及部署智能空調監控系統，以實現我們的節能目標。

水資源管理

我們積極實施節水措施，並持續推廣節約用水，以加強本公司全體人員的節水意識。為減少消耗，我們在營運中堅持負責任的水資源管理及高效利用水資源，而我們的用水強度已開始下降。本公司的耗水量僅包括辦公設施的使用量。

下表載列於往績記錄期間的水資源使用情況：

類別	單位	截至2023年12月31日止年度	截至2024年12月31日止年度	截至2025年12月31日止年度	截至2026年3月31日止三個月
用水量	噸	1,275.00	1,537.00	1,527	390
用水強度	噸／人民幣百萬元收入	1.81	1.49	1.25	1.39

廢棄物管理

我們堅持合規處置廢棄物，並致力於透過針對性的管理措施從源頭減少廢棄物。於日常營運中，我們產生的廢棄物主要為無害廢棄物，且主要源自我們的辦公及研發活動，包括廚餘及一般辦公室垃圾。我們的營運不涉及有害廢棄物，亦不產生其他污染物排放。

社會責任

僱傭

我們遵守業務經營所在司法管轄區的適用僱傭法律，並已建立及實施內部管理制度(包括《招聘管理辦法》及《人員配置管理辦法》)，以保障員工的合法勞動權益。我們禁止任何形式的童工及強制勞工，並致力於營造公平、平等及和諧的工作環境。

下表載列我們於往績記錄期間的僱員數據：

類別	截至2023年12月31日止年度	截至2024年12月31日止年度	截至2025年12月31日止年度	截至2026年3月31日止三個月
僱員總數	271	322	352	351
僱員流失總數	25	34	32	18
按性別劃分的僱員總數				
男性	190	226	243	242
女性	81	96	109	109
按年齡組別劃分的僱員總數				
30歲以下	76	88	108	103
30歲至50歲	174	219	226	231
50歲以上	21	15	18	17
按類別劃分的僱員總數				
主要管理人員(1)	16	15	12	10
一般員工	255	307	340	341
按地區劃分的僱員總數				
中國內地	264	314	344	343
香港、澳門、台灣	3	4	4	4
海外	4	4	4	4

附註：

(1) 包括董事、監事、高級管理人員及核心技術人員。

關懷和福利

我們致力於為僱員提供廣泛的薪酬福利體系、多元化的工作環境及系統化的職業發展路徑。我們為員工及其家人提供多方面的健康支持，有效提升團隊的整體身心健康水平。此外，我們已建立公平且具競爭力的薪酬體系。通過市場對標分析，我們不斷完善薪酬及激勵政策。我們亦已實施系統化及標準化的績效管理體系，每年對全體員工進行評估，以評估工作表現、能力及發展潛力，作為薪酬決策、職業發展及人才培養的重要依據。

培訓及發展

我們高度重視全球人才隊伍的建設與發展，並透過系統化、多維度的人才發展機制，持續提升我們的組織能力。

就僱員培訓及發展而言，我們已建立一套涵蓋領導力、通用技能及專業能力的結構化培訓體系，旨在加強員工的專業勝任能力及管理能力。展望未來，我們將繼續優化人才培養機制，為本公司的可持續發展提供強有力的人才支撐。

我們亦建立了規範透明的晉升機制，提供多元化的職業發展路徑，並透過結構化的考核流程確保公平性。於實踐中，我們提供多條發展路徑，讓員工能夠選擇與其優勢相符的職業方向。晉升評估考慮工作表現、專業能力及其他相關因素，以確保全面甄選，營造有利的發展環境，推動僱員與本公司共同進步。

下表載列我們於往績記錄期間的僱員培訓數據：

類別	單位	截至2023年12月31日止年度	截至2024年12月31日止年度	截至2025年12月31日止年度	截至2026年3月31日止三個月
培訓總出席人數	人次	665	508	573	25
平均受訓時數	小時	24.87	24.9	23.3	8

職業健康與安全

我們嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國職業病防治法》及國內和海外運營地點的適用法律法規。我們已制定並實施安全指引，以規範工作場所安全及健康管理。我們通過嚴格執行安全管理制度、建立安全績效激勵機制、持續投入安全技術升級等措施，保障員工的工作場所安全和健康。我們為新員工提供入職前體檢，並為全體員工提供年度體檢。我們還定期為全體員工舉行消防安全演習，以加強消防應急知識和技能，並提高整體安全意識。

我們定期為全體僱員組織職業健康與安全培訓，內容涵蓋設備安全、安全法規、施工安全及事故案例研究。此外，我們還通過開展主題宣傳活動和安全技能競賽，不斷強化僱員的安全意識。

在過去三年，我們實現了「零工傷」，期間沒有發生任何工傷亡故、受傷或生產安全事故。

產品責任

我們建立了產品質量安全的戰略性、全過程管理體系。在整個供應鏈中，我們要求我們的主營業務合作夥伴取得IATF 16949等質量認證，且我們會優先選擇同時持有ISO 14001認證的工廠，從而建立涵蓋質量、可靠性及環境責任的共同防線。

我們已建立標準化的產品召回管理機制，以及產品異常反饋、故障分析及質量調查的正式流程，並針對批量問題採用8D報告等閉環工具。當產品因潛在問題而需要召回時，此機制可確保作出快速響應。銷售部門作為統一對外聯絡窗口，負責就召回範圍、原因及處理方案與客戶進行協調，並在內部系統發起退貨授權請求。經跨部門聯合審查批准後，本公司根據既定程序進行產品回收、檢測及更換，確保每批次的召回均透過閉環追溯系統予以記錄、分析及優化。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無經歷任何重大產品召回或更換。

為加強質量追溯及風險防範，我們構建了一個涵蓋客戶投訴、流程數據及產品歷史記錄的數字化平台。此舉持續增強客戶供應鏈的穩定性及產品可靠性。

知識產權保護

我們持續加大研發投入，包括綠色產品。為保護創新成果，本公司已建立專利管理制度等內部制度，並系統化地構建知識產權保護框架，以保護核心技術及商業秘密。

我們已開發一套涵蓋從晶圓製造到封裝及測試全過程的系統。透過端對端量化監控及系統化分析，我們在產品出廠前識別並消除潛在缺陷，從而減少電子廢物及其對環境的影響。此外，透過提高芯片運行效率及集成度，我們降低了單位產品在生產及使用過程中的資源及能源消耗，將綠色製造理念付諸實踐。

供應鏈管理

我們致力於加強供應鏈的可持續管理。我們的措施包括對供應商實施系統化的環境及社會責任風險管理，並在整個供應鏈中促進碳減排。在我們的供應商績效評估體系中，我們計劃將ESG相關指標(包括低碳及社會責任指標)納入為關鍵評分維度。

我們已建立標準化、透明且具前瞻性的供應商社會責任評估體系，並設有明確的「紅線」，嚴禁僱用童工、強制勞工、商業賄賂以及重大安全及環保事件。

本公司秉持公平透明的原則，尋求與供應商建立長期穩定的戰略合作夥伴關係。我們通過定期溝通，響應供應商需求，優化合作流程，積極推進綠色發展戰略，引導供應商踐行可持續發展，共同推進碳足跡減排。我們與上下游合作夥伴共同深化信息共享及資源互補，以提升供應鏈的穩定性及整體競爭力，並助力推動行業邁向可持續發展的未來。

社區貢獻

我們積極履行社會責任，為社會貢獻企業力量。我們致力於將業務發展與社會責任相結合，積極參與社區發展、教育支持、緊急救援、環境保護以及文化體育活動。為系統地履行企業公民責任，我們透過設立專項慈善基金及進行定向捐贈，支持教育及醫療福利。2025年，我們向由中芯國際、上海仁濟醫院及中國宋慶齡基金會聯合主辦的「Chip in for Little Livers」捐贈人民幣100,000元，資助肝病末期兒童的手術治療。展望未來，我們將繼續與社會各界攜手，共同創造可持續的社會價值。

競爭

我們產品及解決方案的市場總體上競爭激烈，其特點是技術持續變革、行業標準不斷演變以及平均售價波動。

我們的競爭對手包括國內外大型半導體公司，彼等可能在關鍵市場擁有更大的影響力、更穩固及龐大的客戶群，且總體上比我們更容易獲得其他資源。因此，彼等可能能夠更快地適應新技術或新興技術及客戶要求，或投入更多資源用於產品的推廣及銷售。有關半導體行業市場環境的描述，請參閱「行業概覽」一節。

僱員

我們以人為本的文化促進內部的可持續增長及外部的客戶聯繫。我們致力於為僱員創造公平、公正及公開的環境。截至2026年3月31日，我們共有351名僱員，其中大部分位於中國。

下表載列截至2026年3月31日按職能劃分的僱員數目。

職能	僱員數目	佔總數百分比(%)
財務	11	3.1
行政	24	6.8
銷售及營銷	68	19.4
研發	196	55.8
生產	34	9.7
質量控制	18	5.1
總計	**351**	**100.0**

我們認識到人才對於可持續業務增長及競爭優勢的重要性。我們相信，我們的成功取決於我們吸引、挽留及激勵合格人員的能力。我們採取多元化的招聘方式，確保關鍵職位有充足的人才儲備。我們主要透過推薦、網上招聘門戶網站及校園招聘會招聘僱員。我們為僱員提供新僱員入職培訓及定期的在職培訓。特別是，我們為研發僱員提供為期兩至三週的專項培訓計劃，幫助他們熟悉研發活動及項目管理。經驗豐富的工程師亦對新研發僱員進行輔導。

與僱員分享成功並賦能其成長是我們企業文化的核心要素之一。我們始終致力於為僱員提供廣泛的社會福利、安全的工作環境及多元化職業發展機會。同時，我們嚴格遵守相關國家及地區關於工作場所安全的法律、法規及標準，致力於為僱員創造安全健康的工作環境，並透過實施高效的管理體系保障僱員的安全及身心健康。

作為我們人力資源戰略的一部分，我們為員工提供相對具有競爭力的薪資、績效獎金及其他激勵安排。此外，我們已實施了一系列長期股權激勵計劃，覆蓋核心管理團隊、關鍵技術人員以及關鍵崗位的骨幹員工，從而將該等員工的個人發展與本公司的長期利益緊密聯繫在一起。本股權激勵計劃項下的授出、歸屬及行權條件，與員工的年度績效考核、貢獻度、服務年限以及本公司戰略目標的達成情況緊密掛鈎，旨在培養員工持續的長期投入精神和強烈的主人翁意識。我們會不時依據既定績效目標的達成能力等多項標準對員工績效進行考核。我們的員工薪酬及福利待遇通常包括薪資、獎金及股權激勵權益，並通常根據資歷、績效考核、服務年限以及相關職位的重要程度等因素來確定。我們亦致力於維持多層次的激勵機制和良好的工作環境，以使員工能夠充分釋放其潛能。因此，我們通常能夠吸引並留住合資格人才，保持核心管理團隊的穩定，從而為本公司的持續健康發展夯實人才基礎。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無經歷任何可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響的重大勞資糾紛或罷工。

知識產權

得益於我們研發團隊的努力，我們能夠開發並擁有一系列重要的知識產權及多項對我們業務運營至關重要的關鍵技術。截至最後實際可行日期，我們在全球擁有80項專利、九項軟件著作權及83項產品佈圖設計證書。

為保護及執行我們的知識產權，我們與供應商訂立框架協議，規定保密義務以在製造過程中保護我們的知識產權。我們已採取多項內部控制政策及措施來保護我們的知識產權及商業秘密：(i)實施內部政策以建立對知識產權的穩健管理；(ii)及時註冊、備案及申請知識產權所有權；(iii)積極追蹤知識產權的註冊及授權狀態，並在發現與我們的知識產權存在任何潛在衝突時及時採取行動；及(iv)聘請專業的知識產權服務提供商。

我們依賴保密協議來維護我們在不可申請專利的專有技術及難以執行專利的製造工藝方面的利益。概不保證我們會在針對第三方的專利侵權索賠中勝訴，我們亦無法向閣下保證我們的產品不侵犯他人持有的專利或將來不會侵犯。據我們所知、所悉及所信，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無受到第三方提出的任何重大知識產權索賠。

數據隱私及信息安全風險管理

我們高度重視信息安全管理，借鑒國際最佳實踐進行運營，並致力於為客戶提供安全可靠的環境。

在業務過程中，我們收集、存儲及處理業務數據及交易數據。我們的業務及交易數據主要包括客戶訂單資料、產品銷售記錄、供應商採購合約、物流及交付數據、財務交易流程及內部營運管理數據。由於我們僅與企業進行交易，因此在正常業務經營過程中無意收集或處理個人數據。若因偶然情況需處理任何非敏感個人數據(例如業務聯繫信息及職務頭銜)，我們將依據適用法律法規及行業標準進行處理。我們的數據存儲在位於中國境內的服務器上，不會跨境轉移。我們並無在中國境外維護任何服務器，亦無就其業務營運或透過其海外附屬公司進行任何跨境數據傳輸或數據處理活動。

我們致力於遵守適用法律、法規及行業標準。我們已制定網絡與信息安全應急預案。透過建立確保全覆蓋的高標準信息安全管理體系，我們為信息安全奠定了堅實基礎，惠及國內及國際客戶。為加強信息安全管理體系，我們已實施關鍵政策及框架，以主動評估及應對網絡安全風險，保護我們的資產並最大限度地減少漏洞。

此外，我們透過在雲端、本地及遠程位置為同一長時間維度的信息及數據設置多重存儲，為服務器建立了遠程災難恢復系統。即使服務器因地震、泥石流及其他不可抗力自然災害等最高級別災害而受損，我們相信仍能保障及保證服務及數據可在24小時內完全恢復。

我們所有僱員均須與我們簽署保密協議，禁止未經我們同意披露任何與其工作相關的機密信息。我們擁有結構化的數據備份系統，將數據加密並存儲在不同位置的服務器上，以最大限度地降低數據丟失風險。我們亦定期進行數據恢復測試，以檢查備份系統的狀態。

我們將努力維持安全保護並不斷改善我們的控制，以支持我們信息資產的安全及我們運營的連續性。

基於上文所述，我們的中國法律顧問認為，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們的業務運營在所有重大方面一直遵守相關數據隱私及網絡安全法律法規。

法律訴訟及合規

據我們的中國法律顧問告知，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並非任何重大法律、仲裁或行政訴訟的一方，且我們並不知悉任何針對我們或我們董事的未決或擬提起的重大法律、仲裁或行政訴訟。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無牽涉任何重大不合規事件。基於上文所述，我們的董事認為，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們的業務運營在所有重大方面均符合適用法律法規。

風險管理及內部控制

我們董事會有責任確保我們始終維持健全有效的內部控制及風險管理體系，以保障我們股東的投資及我們的資產。我們已在業務運營的各個方面(如財務報告、合規以及反賄賂及反回扣)採納並實施風險管理政策。我們的董事會及總經理負責建立、更新及實施我們的內部控制政策及制度，而我們的管理團隊則監控職能團隊對內部控制程序及措施的日常執行情況。

為監控[**編纂**]後風險管理政策及企業管治措施的持續實施，我們已採取或將繼續採取以下風險管理措施：

- 我們的董事會負責監控我們的內部控制體系，評估其有效性並維持適當有效的風險承受水平。

- 我們的審計部門協助管理層制定風險管理政策及審查重大風險管理事宜，就風險管理措施向相關部門提供指導，並監督風險管理政策的實施。

- 我們的財務部門、法律合規部門、人力資源部門及其他相關部門負責實施我們的風險管理政策及進行日常風險管理活動。

- 必要時，我們聘請外部專業顧問、內部控制顧問與我們的內部審計及法律團隊合作，進行定期審查，以確保所有註冊、執照、許可證、備案及批准的有效性。

- [**編纂**]後由外部法律顧問定期向我們的董事及高級管理層提供有關遵守相關上市規則要求及適用中國法律法規的培訓。

此外，我們已採取一系列措施以減輕賄賂及腐敗風險：

- 我們已發佈有關反賄賂及反腐敗的政策，其中包括監控、接受升級上報、處理調查及報告包括賄賂及腐敗在內的不合規行為的指引。

- 我們已設立舉報機制，包括報告渠道(電子郵件)、調查程序及對已發現問題的響應。

- 我們已發佈有關控制經濟制裁風險的政策。我們的法律及業務經理負責審查及控制該等風險，該政策亦包括相關實施程序。

- 向所有僱員(包括新僱員)提供合規培訓。

為確保持續遵守適用的法律法規，我們制定了「法律及合規管理程序」，並建立了合規風險管理機制。各部門定期審查適用於其業務活動的法律、法規、監管要求和行業標準，主動識別潛在的合規風險點，尤其關注反商業賄賂、資料安全、出口管制、關連交易和資料洩露等高風險領域。員工或部門如發現重大法律或合規風險，須立即上報。一旦出現合規風險，人力資源部門將聯合相關業務部門和外部法律顧問，評估

風險等級，制定應對措施(例如暫停業務、修訂流程和啟動調查)，並明確整改時間表和責任單位。我們也對已識別的風險實施賬簿管理系統，透過定期跟進、內部檢查或審計追蹤整改進展，以確保措施有效實施。重大風險事項將記錄在合規報告中，提交總經理和董事會進行報告。此外，我們強制要求對某些關鍵業務管理活動進行合規評估，並將評估結果按要求提交給相關人員進行合規審查。

關稅及出口管制政策監控

我們的業務營運及財務表現可能會受到地緣政治風險的影響。地緣政治的緊張局勢已導致並將可能繼續造成國際貿易政策的變化，並增加關稅和出口限制的額外貿易壁壘。此外，近期的貿易緊張局勢(例如持續的中美貿易爭端)已導致高額關稅、更廣泛的出口管制及其他針對高科技產品、半導體及電子產品的限制性措施。截至最後實際可行日期，我們的產品受於2018年施行的第301條的徵收50%關稅及於2025年12月施行的第301條的徵收0%關稅(將於2027年6月23日上調)的限制。於2026年7月24日，USTR就其強迫勞動調查對中國產品徵收12.5%的額外關稅。然而，我們的產品獲豁免此12.5%額外關稅。第122條規定的10%關稅已被美國國際貿易法院裁定無效，並於2026年7月24日失效。所有IEEPA關稅均已被撤銷。

於2023年、2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月，我們對美國直接出口產生的收入分別為人民幣4.7百萬元、人民幣4.0百萬元、人民幣5.9百萬元及人民幣2.4百萬元，分別佔我們各自年度／期間的總收入的0.67%、0.38%、0.49%及0.86%。截至最後實際可行日期，我們並無擴展美國業務的具體計劃。經考慮DLA Piper的意見，董事認為，近期美國的關稅措施並無且預期亦不會對我們的業務營運或財務狀況產生重大影響。於往績記錄期間，我們來自美國的收入並不重大，且我們並不依賴美國市場作為主要收入來源。因此，任何新增的美國關稅措施預期對我們的銷售額、利潤率或整體財務表現的直接影響有限。我們的產品及業務營運並不依賴對美國的出口或自美國的進口。我們的採購及製造活動主要於美國境外進行，且除已披露者外，我們的主要投入品概無受到新徵收的美國關稅的重大影響。然而，我們的產品可能會被整合至進口到美國的終端產品中，在該情況下，任何適用的關稅通常由進口商承擔。該等關稅可能會增加客戶的成本，客戶可能會尋求將該等成本轉嫁至供應鏈，繼而可能影響我們的業務。即使該等成本並未轉嫁予我們，該等終端產品在美國市場的競爭力下降亦可能導致需求減少及向我們下達的訂單減少。此外，美國貿易政策仍可能發生變化，包括可能會擴大關稅措施的範圍或涵蓋面。然而，截至最後實際可行日期，經考慮我們對美國的風險敞口有限及現有的業務模式，並無具體跡象表明該等事態發展將會對我們的營運或財務狀況產生重大影響。

《出口管制條例》(「**出口管制條例**」)規範美國的出口管制，而美國商務部工業與安全局(「**BIS**」)負責管理出口管制條例。美國的出口管制制度根據產品或技術的性質，以及特定出口或轉讓的目的地、受讓人或最終用途，對美國產品、軟件和技術向非美國司法管轄區和非美國人士的出口、轉讓或披露進行監管。於往績記錄期間，我們採購用於芯片組設計及開發的EDA軟件總成本為1.3百萬美元。我們並無以其他方式採購任何原產於美國的原材料、組件、軟件、IP核心或EDA工具。據我們所知，我們的供應商概無採購任何原產於美國的原材料、組件、軟件、IP核或EDA工具。由於受出口管制條例約束，我們購買及使用EDA軟件必須遵循出口管制條例的要求。據DLA Piper告知，就我們採購的受出口管制條例規限的EDA軟件而言，我們的採購將不需要許可證或將根據供應商提供的分類獲得許可證豁免，因為(i)其不敏感或相對較不敏感，(ii)中國並非出口管制條例界定的禁運國家或受全面管制，及(iii)本公司並非受制裁目標，且最終用途不受限制。據DLA Piper告知，我們可以在沒有出口許可證的情況下使用軟件，只要我們不採取違反出口管制條例的行動。儘管如此，針對半導體行業的美國出口管制措施不斷演變，且在某些情況下，已實施對中國供應EDA軟件的限制，並隨後於較短時間內作出調整或撤銷。該等事態發展可能表明，在持續獲取美國原產EDA軟件方面存在一定程度的監管不確定性。截至最後實際可行日期及據DLA Piper告知，董事並不知悉有任何計劃中的監管變更會影響本公司目前獲取EDA軟件。倘美國出口管制措施變得更為嚴格，董事認為，我們可獲取並使用國內可用的EDA軟件以替代美國原產EDA軟件來支持我們的常規研發活動，且不會對我們的研發活動、產品開發時間表及成本產生重大影響。

我們採取合規措施以履行我們在美國出口管制法律項下的義務，包括(i)指定法務部門的特定人員在日常業務中採取一切必要的合規措施；(ii)對我們的交易對手進行例行篩查，並評估與交易對手進行交易的適用限制；(iii)要求客戶簽署出口管制合規承諾；(iv)要求我們的供應商及合約製造商完成盡職調查問卷，以確定提供予我們的項目及製造我們產品的過程中使用的項目是否受出口管制條例規管；(v)在與供應商的合約中確認適用的貿易合規責任；(vi)與我們的合約製造商溝通，以確保向我們提供的資料為準確且最新；及(vii)安排我們的合規及技術團隊審閱及評估我們最終產品的相關出口管制分類。我們亦定期諮詢我們的外部美國出口管制法律顧問，以監察法律、法規及最佳合規實踐的發展。據DLA Piper告知，基於對我們相關合規手冊、篩查程序及上述措施的審閱，並考慮我們目前的供應鏈、業務模式及客戶基礎，我們的貿易合規計劃對於管理出口管制風險屬合理充足且有效。

基於上述分析，包括(i)對美國的最低直接收入敞口；(ii)除往績記錄期間採購的EDA工具外，並無任何原產於美國的原材料、組件、IP內核或EDA工具；及(iii)本公司實施的相關內部控制及合規措施，董事認為近期美國貿易限制及關稅對本集團業務營運及財務表現的實際及潛在影響並不重大。經計及DLA Piper的法律意見、對我們的評估及獨家保薦人進行的盡職調查後，獨家保薦人並無注意到任何事項會合理導致其對董事觀點產生懷疑。

美國境外投資規則的影響

於2024年10月28日，美國財政部（「**財政部**」）發佈一項最終規則，其被編入美國聯邦法規31C.F.R.第850部分，以落實2023年8月9日發佈的第14105號行政命令（「**最終規則**」），自2025年1月2日起生效。請參閱「監管概覽 — 美國境外投資規則」。

據DLA Piper告知，我們的董事認為，由於我們從事31 C.F.R.§850.217中「須予公佈交易」定義所述的集成電路設計業務，因此很可能被視為從事一項「受管轄活動」（包括(i)半導體及微電子；(ii)量子信息技術；及(iii)人工智能系統）的受管轄外國人士。我們並無直接或間接從事任何「禁止交易」定義所述的「受管轄活動」（定義均見最終規則），此乃由於我們並不設計、製造或封裝任何具有最終規則所定義的禁止交易所涵蓋的先進集成電路性能參數的集成電路。據DLA Piper告知，受最終規則管轄的美國人士被禁止進行或需報告對受管轄外國人士的特定投資，這些投資定義為「受管轄交易」，包括特定股權收購、特定債務融資、合資企業，以及作為有限合夥人對非美國人士集合投資基金的特定投資。參與涉及收購我們股權（包括[**編纂**]中[**編纂**]我們的H股）的「受管轄交易」的美國人士，可能需要根據最終規則向財政部提交通知。具體而言，倘美國人士參與涉及收購本公司非公開交易股權的交易，則根據最終規則，美國人士可能須向美國財政部作出通知。儘管該等規定可能會令潛在美國投資者產生額外的合規責任，但董事經考慮DLA Piper的意見後認為，預期該等規定本身不會對參與[**編纂**]構成重大阻礙，尤其是在投資將屬於須予公佈（而非禁止類）交易類別的情況下。

基於上文所述及據DLA Piper告知，從事「須予公佈交易」的美國人士有責任根據最終規則向財政部提交通知，我們的董事認為最終規則預期不會對我們的業務、經營業績、財務狀況或[**編纂**]產生重大不利影響。經考慮DLA Piper的法律意見、對我們的評估以及獨家保薦人所進行的盡職審查，獨家保薦人概無發現任何事宜會合理導致其質疑我們董事的意見。

然而，無法保證財政部將與我們持相同的看法。未來最終規則、美國優先備忘錄及任何相關政策、法律及法規或其詮釋的變更，或美國或其他司法管轄區施加的任何類似或更廣泛的限制，可能會對我們的業務造成額外成本及／或限制我們從美國投資者及其他可能對我們有利的來源籌集資本或或然股本的能力，這可能對我們的表現、財務狀況及前景造成不利影響，在這種情況下，我們H股的[**編纂**]也可能受到重大不利影響。請參閱「風險因素 — 我們面臨與14105號美國行政命令及其實施法規相關的風險，其禁止並要求美國人士就特定投資進行通知」。

土地及物業

自有物業

我們在上海擁有物業。我們已取得所有該等物業的房屋所有權證。截至最後實際可行日期，我們持有每項該等房地產物業的業權。我們使用該等建設用地的權利合法

有效，且該等土地的所有權不存在糾紛或潛在糾紛。自有物業並未為任何債務提供擔保，亦無用作抵押的抵押品。下表載列截至最後實際可行日期我們擁有的物業概要。

地點	實際用途	面積
		(平方米)
中國(上海)自由貿易試驗區張東路1761號10幢...	辦公、研發	4,734.37

誠如我們的中國法律顧問所確認，本公司合法有效地擁有該物業，不存在任何現有或潛在的所有權爭議。

租賃物業

此外，我們持有九項主要用作辦公室及倉庫的租賃物業。截至最後實際可行日期，我們並未收到任何第三方就我們的租賃物業主張任何權利或權益，或以其他方式對我們於該等租賃物業的權利及權益提出爭議。截至最後實際可行日期，有6份租賃協議尚未登記，需要業主配合。據我們的中國法律顧問告知，未能登記該等租賃物業的租賃協議本身不會影響相關租賃協議的有效性或可執行性，亦不會限制我們繼續使用該等租賃物業的權利，或對我們的營運造成重大不利影響。然而，倘我們於接獲中國內地相關主管部門的通知後未能在規定時限內完成登記，我們可能會就每份未登記的租賃被處以人民幣1,000元至人民幣10,000元的罰款。考慮到(i)據我們的中國法律顧問告知，若干租賃協議未作登記並不構成我們的重大或系統性不合規行為；(ii)潛在行政處罰的最高總額並不重大；及(iii)我們正積極整改該等不合規事件，董事認為，且獨家保薦人同意，若干物業租賃未登記並不構成重大或系統性不合規事件。

截至2026年3月31日，我們租賃或擁有的物業中，概無賬面值佔我們資產總值15%或以上者。根據香港上市規則第五章及公司(豁免公司及招股章程遵守條文)公告第6(2)條，本文件獲豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例第342(1)(b)條的規定，即無須按公司(清盤及雜項條文)條例附表三第34(2)段所述在估值報告中列入所有土地或建築物的權益。

執照、許可證及批准

我們須接受定期檢查、審查及審核，並須維持或重續我們運營所需的許可證、執照及證明。我們會不時重續所有該等重大許可證及執照，以在所有重大方面遵守相關法律法規。我們現有執照、許可證及批准能否成功重續將取決於我們是否滿足相關要求。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們在重續該等證明、許可證及執照方面並無遇到任何重大困難，且只要我們遵守相關法律法規設定的適用要求及條件，我們預計在該等重續方面不會遇到任何重大困難。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們已從主管政府部門及監管機構獲得在我們運營所在司法管轄區對我們的業務運營至關重要的所有必要執照、批准及許可證且所有此類執照、許可證、批准及證書均保持有效。

保險

於往績記錄期間，我們按照中國社會保險法規的要求為僱員提供強制性社會保險，如養老保險、失業保險、工傷保險及醫療保險。於往績記錄期間，我們按照適用中國法律法規，為所有僱員足額繳付社會保險及住房公積金，截至最後實際可行日期並無重大未繳款項。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無遭受任何項目責任索賠。我們的董事認為我們的整體保險政策符合一般市場慣例，並遵守中國相關規則及法規。我們為設施投購了上述保險，並已為進出口貨物運輸及國內貨物運輸投購了預約保險。我們亦為自身運營投購了財產險。根據弗若斯特沙利文的資料，我們目前的投保範圍符合行業慣例。基於上文所述，董事認為有關覆蓋範圍足以滿足我們的經營需要。

獎項及嘉許

下表載列我們在過去的幾年獲得的若干獎項及取得的若干成就：

年份	獎項或嘉許名稱	頒發機構
2026年 . . .	上海市創新型企業總部	上海市戰略性新興產業領導小組辦公室
2026年 . . .	2025上海專精特新企業品牌價值100強	上海專精特新企業品牌價值評價委員會及上海企業文化與品牌研究所
2026年 . . .	2026汽車電子金芯獎－創新應用獎；2026國產車規芯片新品30強	第十三屆汽車電子創新大會暨車規半導體技術與應用展
2025年 . . .	IC風雲榜「年度半導體上市公司領航獎(車載存儲類)」	半導體投資聯盟

年份	獎項或嘉許名稱	頒發機構
2025年 . . .	2025科創板價值50強	中央廣播電視總台及上海市人民政府
2025年 . . .	2025中國汽車芯片創新成果	中國汽車工業協會
2025年 . . .	2025年度企業社會責任銀牌	EcoVadis
2024年 . . .	2024年上海市製造業單項冠軍企業	上海市經濟和信息化委員會
2024年 . . .	2024中國汽車芯片創新成果	中國汽車工業協會
2024年 . . .	2024年中國IC設計成就獎之2024年度最佳存儲器	Aspencore、EET電子工程專輯、EDN電子技術設計、ESM國際電子商情
2023年 . . .	國家級專精特新「小巨人」企業	中華人民共和國工業和信息化部
2022年 . . .	2022年中國汽車芯片創新大賽「最具創新性汽車芯片」	國家新能源汽車技術創新中心、中國汽車芯片產業創新戰略聯盟